

技术白皮书

09

2020-06-05



华为技术有限公司

版权所有 © 华为技术有限公司 2020。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编： 518129

网址： <https://e.huawei.com>

前言

概述

本文档详细介绍5885H V5的外观特点、性能参数以及部件兼容性等内容，让用户对5885H V5有一个深入细致的了解。

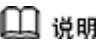
读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 华为售前工程师
- 渠道伙伴售前工程师
- 企业售前工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示如不可避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不可避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不可避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
 须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不可避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
09	2020-06-05	● 第九次正式发布。
08	2020-04-20	● 第八次正式发布。
07	2019-11-15	● 第七次正式发布。
06	2019-08-23	● 增加支持Cascade Lake CPU。
05	2018-11-30	● 第五次正式发布。
04	2018-07-23	● 第四次正式发布。
03	2018-06-15	● 第三次正式发布。
02	2018-05-08	● 第二次正式发布
01	2018-04-12	● 首次发布。

目 录

前言.....	ii
1 产品概述.....	1
2 产品特点.....	2
3 物理结构.....	5
4 逻辑结构.....	7
5 硬件描述.....	10
5.1 前面板.....	10
5.1.1 外观.....	10
5.1.2 指示灯和按钮.....	12
5.1.3 接口.....	15
5.2 后面板.....	17
5.2.1 外观.....	18
5.2.2 指示灯.....	19
5.2.3 接口.....	21
5.3 处理器.....	23
5.4 内存.....	24
5.4.1 内存标识.....	24
5.4.2 内存子系统体系结构.....	25
5.4.3 内存兼容性信息.....	27
5.4.4 内存安装准则.....	28
5.4.5 内存插槽位置.....	29
5.4.6 内存保护技术.....	32
5.5 存储.....	33
5.5.1 硬盘配置.....	33
5.5.2 硬盘编号.....	33
5.5.3 硬盘指示灯.....	35
5.5.4 RAID 控制卡.....	36
5.6 IO 扩展.....	36
5.6.1 PCIe 卡.....	36
5.6.2 PCIe 插槽.....	36
5.6.3 PCIe 插槽说明.....	37

5.7 电源.....	38
5.8 风扇.....	39
5.9 LCD 模块.....	40
5.10 单板.....	41
5.10.1 主板.....	42
5.10.2 扣板.....	43
5.10.3 硬盘背板.....	45
6 产品规格.....	48
6.1 技术规格.....	48
6.2 环境规格.....	52
6.3 物理规格.....	53
7 软硬件兼容性.....	55
8 管制信息.....	56
8.1 安全.....	56
8.2 维保与保修.....	59
9 系统管理.....	60
10 通过的认证.....	62
A 附录.....	65
A.1 产品序列号.....	65
A.2 工作温度规格限制.....	66
A.3 RAS 特性.....	67
A.4 传感器列表.....	69
B 术语.....	74
B.1 A-E.....	74
B.2 F-J.....	74
B.3 K-O.....	75
B.4 P-T.....	75
B.5 U-Z.....	76
C 缩略语.....	77
C.1 A-E.....	77
C.2 F-J.....	78
C.3 K-O.....	80
C.4 P-T.....	80
C.5 U-Z.....	82

1 产品概述

华为FusionServer Pro 5885H V5服务器（铭牌型号H58H-05，以下简称5885H V5）是华为公司针对IDC（Internet Data Center）、云计算、企业市场以及电信业务应用等需求，推出的具有广泛用途的4U4路机架服务器。

5885H V5适用于数据库、云计算、虚拟化、内存计算等各种应用需求。

5885H V5具有高性能计算、大容量存储、低能耗、扩展能力强、高可靠、易管理、易部署、虚拟化应用密度高等优点。

图 1-1 5885H V5（25 块硬盘配置）



2 产品特点

可扩展性和性能

- 支持英特尔®至强®可扩展处理器（Skylake, Cascade Lake），通过高达28核处理器提供卓越的系统性能、最高主频3.8GHz、38.5MB L3缓存和最多3条10.4GT/s UPI互连链路，使服务器拥有最高的处理性能：
 - 支持最大4个处理器、112个内核和224个线程，能够最大限度地提高多线程应用的并发执行能力。
 - 优化处理器cache分层分级架构，增加L2 cache容量，内存数据直接进入L2 cache处理可大幅提升内存访问性能，每个核可独占1MB L2缓存，减少L3缓存容量，单处理器可共享最大38.5MB L3缓存。
 - 支持Intel最新2.0版本的睿频加速技术（Turbo Boost Technology），提供智能的自适应系统功能，允许CPU内核在工作负载高峰期临时超越处理器TDP（Thermal Design Power），以最大频率运行。
 - 支持Intel超线程技术，允许每个处理器内核中并发运行多个线程（每个内核最多2个线程），从而提高多线程应用的性能。
 - 支持Intel虚拟化技术，集成了硬件级虚拟化功能，允许操作系统供应商更好地利用硬件来处理虚拟化工作负载。
 - 支持Intel高级矢量扩展指令集512（Intel AVX-512），借助多达两个512位融合乘加(FMA)单元，应用程序在512位矢量内的每个时钟周期每秒可达到32次双精度和64次单精度浮点运算，以及八个64位和十六个32位整数。因此，与英特尔®高级矢量扩展2.0（Intel AVX 2.0）相比，数据寄存器的宽度、数量以及FMA单元的宽度都增加了一倍。
 - 支持Intel DL Boost（VNNI）指令，提升在深度学习应用上的性能（仅Cascade Lake CPU）。
- 支持最大48条2933 MT/s DDR4 ECC内存，内存支持RDIMM（Registered Dual In-line Memory Module）和LRDIMM（Load-Reduced DIMM）类型，可提供优异的速度、高可用性及最多6144GB的内存容量，理论最大内存带宽是549.9 GB/s（仅Cascade Lake CPU）。
- 支持多种灵活的硬盘配置方案，提供了弹性的、可扩展的存储容量空间，满足不同存储容量的需求和升级要求。
- 支持全部配置SSD（Solid-state Drive），其I/O性能显著高于混用SSD与HDD（Hard Disk Drive）或全部配置HDD，与典型的HDD相比，SSD可支持近100倍的每秒I/O操作次数（IOPS）。
- 支持12 Gbps串行连接SCSI（SAS），内部存储连接数据传输速率相比于6 Gb SAS解决方案提高了一倍，以最大限度地提高存储I/O密集型应用程序的性能。

- 支持Intel集成I/O技术，可将PCIe 3.0控制器集成到英特尔®至强®可扩展处理器中，能够显著缩短I/O延迟并且提高总体系统性能。
- 支持最大15个PCIe 3.0标准扩展插槽。

可用性和可服务性特点

- 单板硬件采用电信级器件及加工工艺流程，可显著提高系统可靠性。
- 支持热插拔的SAS/SATA/NVMe硬盘，支持RAID 0/1/1E/10/5/50/6/60，不同的RAID控制卡支持的RAID级别不同。提供RAID Cache，支持超级电容掉电数据保护。
- 面板提供UID/Healthy LED指示灯、故障诊断数码管、可触控LCD诊断面板，iBMC Web管理界面提供关键部件指示状态，能够指引技术人员快速找到已经发生故障或存在故障风险的组件，从而简化维护工作、加快解决问题的速度，并且提高系统可用性。
- 使用SSD后的可靠性远远高于传统机械硬盘，从而能够延长系统运行时间。
- 板载的BMC集成管理模块（iBMC）能够持续监控系统参数、触发告警，并且采取恢复措施，以便最大限度地避免停机。
- 中国区保修级别为3年内第二个工作日7x10客户可替换单元和现场有限保修，提供可选的服务升级。
- 海外保修级别为3年内第二个工作日9x5响应服务申请，华为收到客户坏件后45个日历日内将修复件或替换件发出。

可管理性及安全性特点

- 集成在服务器上的iBMC管理模块可用来监控系统运行状态，并提供远程管理功能。
- 支持BIOS菜单密码，保证系统启动及系统管理的安全性。
- 支持边带管理（NC-SI）特性，支持管理网口和业务网口复用，保护客户投资。NC-SI特性可以通过iBMC智能管理系统和BIOS启用或关闭，NC-SI特性默认为关闭。
- 集成了业界标准的统一可扩展固件接口（UEFI），因此能够提高设置、配置和更新效率并且简化错误处理流程。
- 支持带锁的服务器机箱安全面板，保护服务器的本地数据的安全性。
- 支持Intel执行禁位（Execute Disable Bit）功能，与支持的操作系统联合使用时，可防止某些类型的恶意缓冲溢流攻击。
- 支持Intel可信执行技术（Trusted Execution Technology），可基于硬件抵御恶意软件攻击，允许应用运行在自己的独立空间中，保护它们不受到系统中运行的所有其他软件的影响，从而增强安全性。
- 支持可信平台模块（TPM）和可信密码模块（TCM），可提供高级加密功能，如数字签名及远程验证等。

说明

NC-SI特性的业务网口支持以下配置：

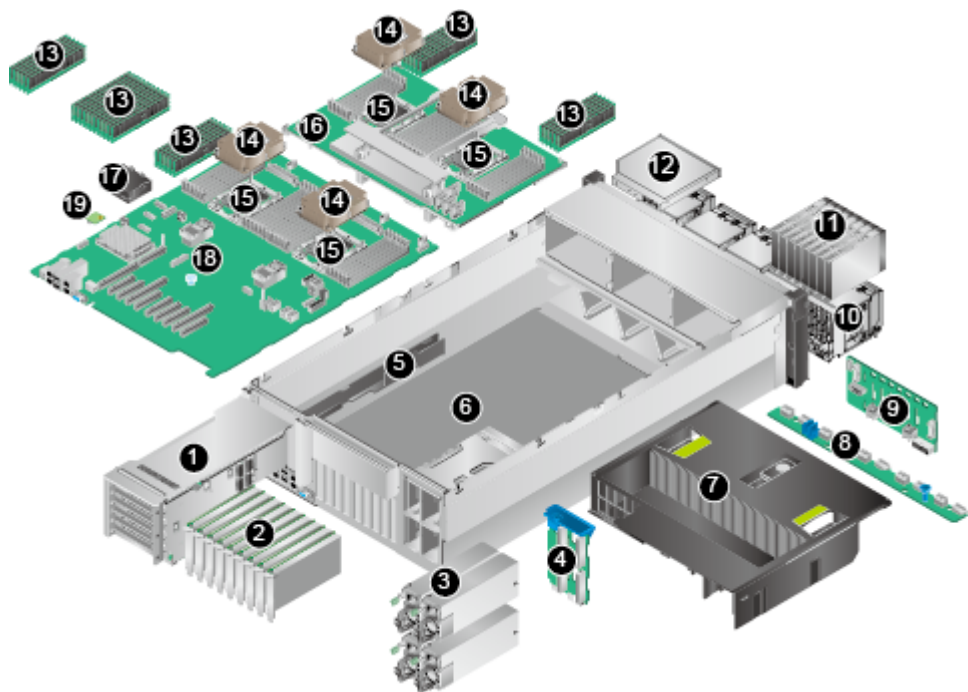
- 该业务网口可以绑定到服务器的板载网卡的任一网口，默认为主机网口1。
- 该业务网口支持虚拟局域网VLAN ID（Virtual Local Area Network ID）的开关和配置。VLAN ID默认为关闭，默认值为0。
- 该业务网口支持IPv4和IPv6地址，可配置IP地址、子网掩码、默认网关或者IPv6地址的前缀长度。

能源效率

- 提供不同功率等级的80PLUS白金电源模块，50%负载下电源模块效率高达94%。
- 高效率的单板VRD（Voltage Regulator Down）电源，降低主板DC电源转换的损耗。
- 支持系统散热风扇分区调速和PID（Proportional-Integral-Derivative）智能调速、CPU智能调频，节能降耗。
- 全方位优化的系统散热设计，高效节能的系统散热风扇，降低系统散热能耗。
- 提供功率封顶和功率控制措施。
- 硬盘错峰上电技术，降低服务器启动功耗。
- 支持Intel智能电源管理功能（Intelligent Power Capability），可根据需要为单个处理器单元通电或断电，从而降低功耗。
- 低电压的英特尔®至强®可扩展处理器能耗更低，能够满足电力和热力受到限制的数据中心与电信环境的需求。
- SSD的功耗比传统机械硬盘低80%。

3 物理结构

图 3-1 5885H V5（示例：8x2.5 英寸硬盘配置）

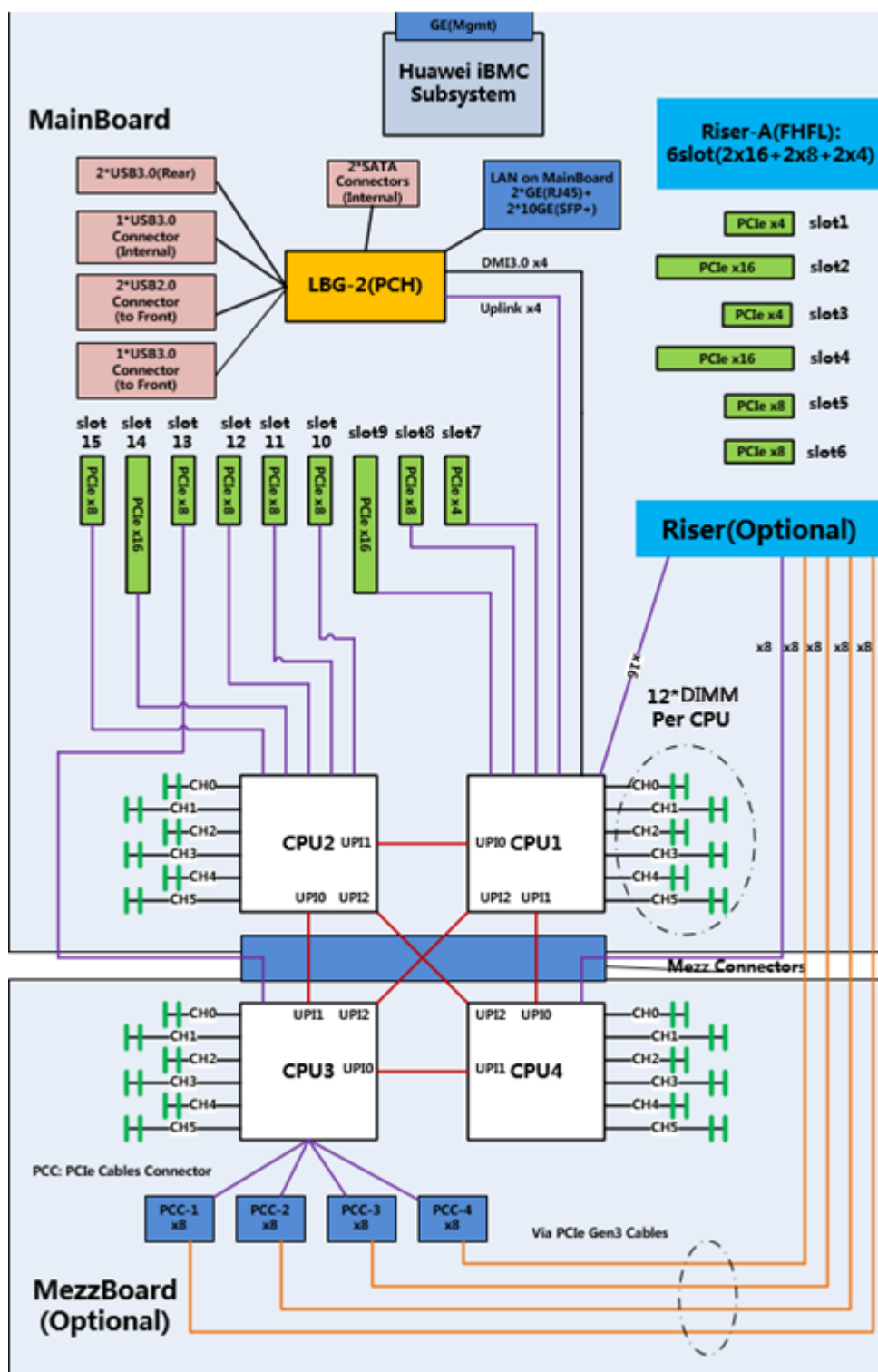


1	Riser卡	2	PCIe卡
3	电源模块	4	电源背板
5	理线架	6	机箱
7	导风罩	8	风扇转接板
9	硬盘背板	10	风扇模块
11	硬盘	12	光驱（或者LCD）
13	内存	14	散热器
15	处理器	16	扣板

17	超级电容	18	主板
19	TPM/TCM扣卡	-	-

4 逻辑结构

图 4-1 5885H V5 逻辑结构



- 支持 2 个或 4 个英特尔® 至强® 可扩展处理器。
- 支持 48 条内存。
- 处理器与处理器之间通过 3 个 UPI (UltraPath Interconnect) 总线互连，传输速率最高可达 10.4GT/s。
- 支持 15 个多种规格的标准 PCIe GEN3 插槽。

- 支持VGA、USB 3.0、串口（RJ45）等低速IO接口。
- 提供2个板载10GE光口和2个板载GE电口。

5 硬件描述

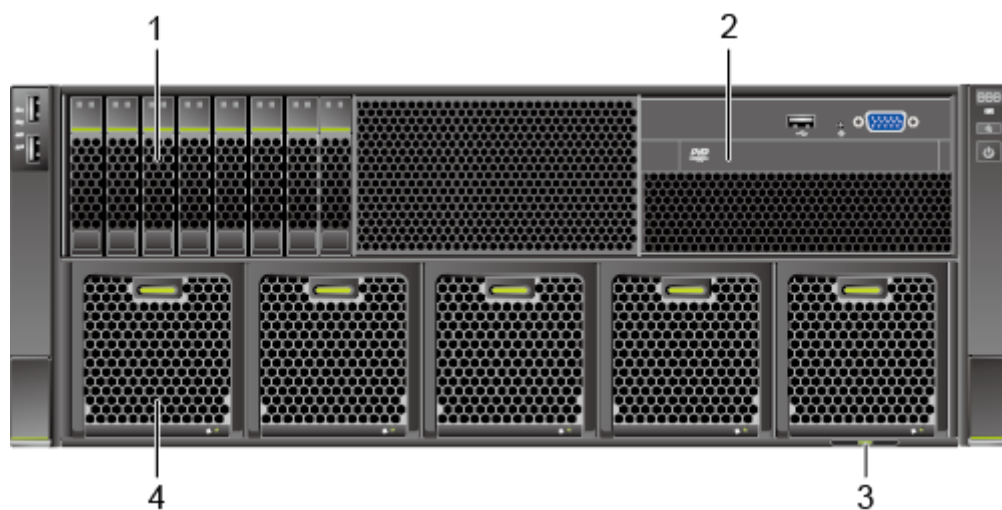
- 5.1 前面板
- 5.2 后面板
- 5.3 处理器
- 5.4 内存
- 5.5 存储
- 5.6 IO扩展
- 5.7 电源
- 5.8 风扇
- 5.9 LCD模块
- 5.10 单板

5.1 前面板

5.1.1 外观

- 8x2.5英寸SAS/SATA硬盘配置

图 5-1 前面板外观



1	硬盘	2	内置DVD（或者可触控LCD模块）
3	标签卡（含SN标签）	4	风扇模块

- 24x2.5英寸硬盘配置（16xSAS/SATA+8xNVMe、24xSAS/SATA）

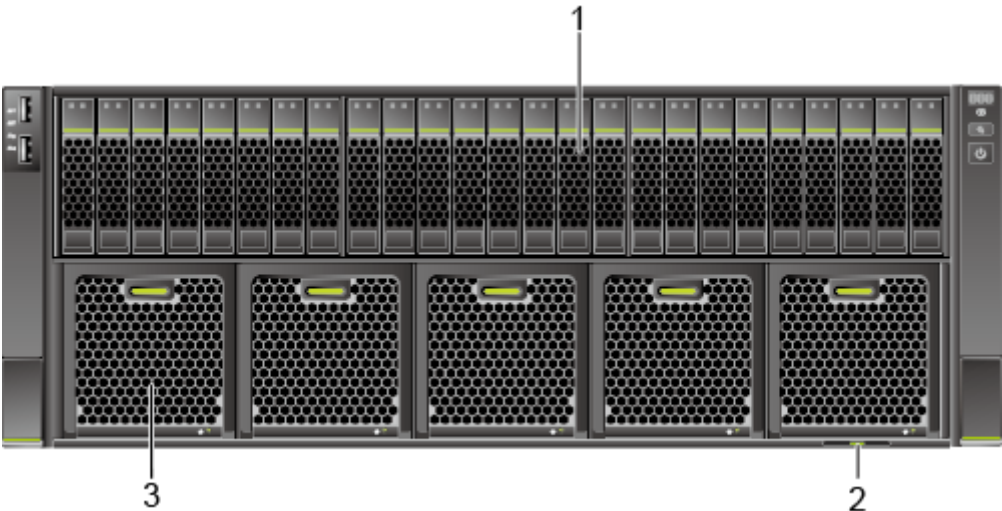
图 5-2 前面板外观



1	硬盘	2	标签卡（含SN标签）
3	风扇模块	-	-

- 25x2.5英寸SAS/SATA硬盘配置

图 5-3 前面板外观



1	硬盘	2	标签卡（含SN标签）
3	风扇模块	-	-

5.1.2 指示灯和按钮

指示灯和按钮位置

- 8x2.5英寸SAS/SATA硬盘配置

图 5-4 前面板指示灯和按钮



1	板载网口1连接状态指示灯	2	板载网口2连接状态指示灯
3	板载网口3连接状态指示灯	4	板载网口4连接状态指示灯
5	NMI（Non-Maskable Interrupt）按键	6	故障诊断数码管
7	健康状态指示灯	8	UID按钮/指示灯
9	电源按钮/指示灯	10	风扇状态指示灯

- 24x2.5英寸硬盘配置（16xSAS/SATA+8xNVMe、24xSAS/SATA）

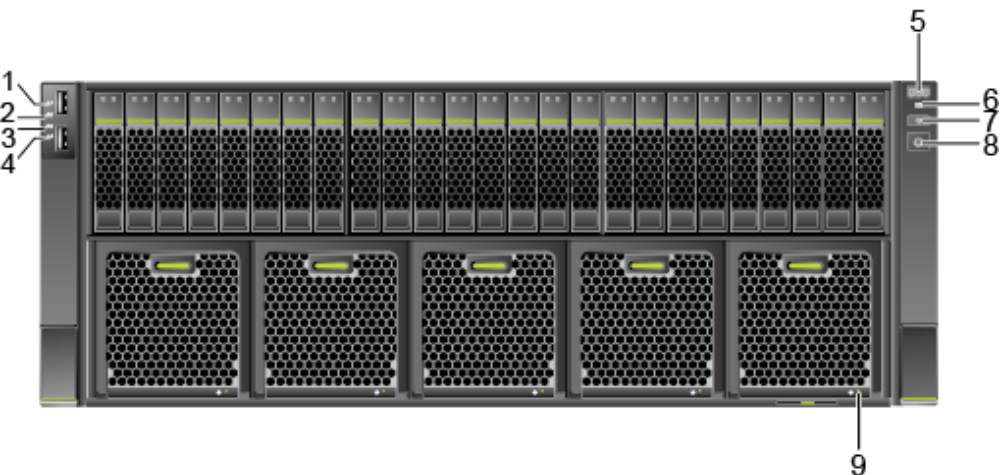
图 5-5 前面板指示灯和按钮



1	板载网口1连接状态指示 灯	2	板载网口2连接状态指示 灯
3	板载网口3连接状态指示 灯	4	板载网口4连接状态指示 灯
5	故障诊断数码管	6	健康状态指示灯
7	UID按钮/指示灯	8	电源按钮/指示灯
9	NMI按键	10	风扇状态指示灯

- 25x2.5英寸SAS/SATA硬盘配置：

图 5-6 前面板指示灯和按钮



1	板载网口1连接状态指示 灯	2	板载网口2连接状态指示 灯
---	------------------	---	------------------

3	板载网口3连接状态指示灯	4	板载网口4连接状态指示灯
5	故障诊断数码管	6	健康状态指示灯
7	UID按钮/指示灯	8	电源按钮/指示灯
9	风扇状态指示灯	-	-

指示灯和按钮说明

表 5-1 前面板指示灯和按钮说明

标识	指示灯和按钮	状态说明
	故障诊断数码管	- 显示---：设备正常。 - 显示故障码：设备有部件故障。故障码的详细信息请参见《FusionServer Pro 机架服务器 iBMC 告警处理》。
	电源按钮/指示灯	电源指示灯说明： - 熄灭：设备未上电。 - 绿色常亮：设备正常上电。 - 黄色闪烁：电源按钮暂时处于锁定状态，不能进行操作。设备刚上电，管理系统正在启动时，电源按钮会处于锁定状态。 - 黄色常亮：设备待上电。 电源按钮说明： - 上电状态下短按电源按钮，OS正常关机。 - 上电状态下长按电源按钮6秒钟，可以将设备强制下电。 - 待上电状态下短按电源按钮，可以进行上电。
	UID按钮/指示灯	UID按钮/指示灯用于方便地定位待操作的设备。 UID指示灯说明： - 熄灭：设备未被定位。 - 蓝色闪烁：设备被重点定位。 - 蓝色常亮：设备被定位。 UID按钮说明： - 可通过手动按UID按钮、iBMC命令或者iBMC的WebUI远程控制使灯熄灭或灯亮。 - 短按UID按钮，可以打开/关闭定位灯。 - 长按UID按钮4至6秒，可以复位管理系统。

标识	指示灯和按钮	状态说明
	健康状态指示灯	- 熄灭：设备未上电或处于异常状态。 - 红色闪烁（1Hz）：系统有严重告警。 - 红色闪烁（5Hz）：系统有紧急告警。 - 绿色常亮：设备运转正常。
	NMI按键	NMI按键可以触发服务器产生一个不可屏蔽中断。可手动按NMI按键或者通过iBMC的WebUI远程控制。 须知 - NMI按键主要在无法使用操作系统的情况下使用。在服务器正常运行期间，请勿使用该功能。 - 使用NMI按键时需要操作系统中有对应的NMI中断处理程序，否则可能引起系统崩溃。请谨慎使用。
	板载网口连接状态指示灯	对应板载以太网口的连接状态。 - 熄灭：网口未使用或故障。 - 绿色常亮：网口连接正常。 说明 - 对应主板上集成的2个10GE网口和2个GE网口。 - 板载网卡为standby供电，业务系统下电后，板载网卡不会下电。如果网口和其他工作中的网络设备正常连接，网口会继续保持连接状态，指示灯不会熄灭。
	风扇状态指示灯	- 熄灭：设备未上电。 - 红色闪烁：风扇存在告警。 - 绿色常亮：风扇正常运作。

5.1.3 接口

接口位置

- 8x2.5英寸SAS/SATA硬盘配置

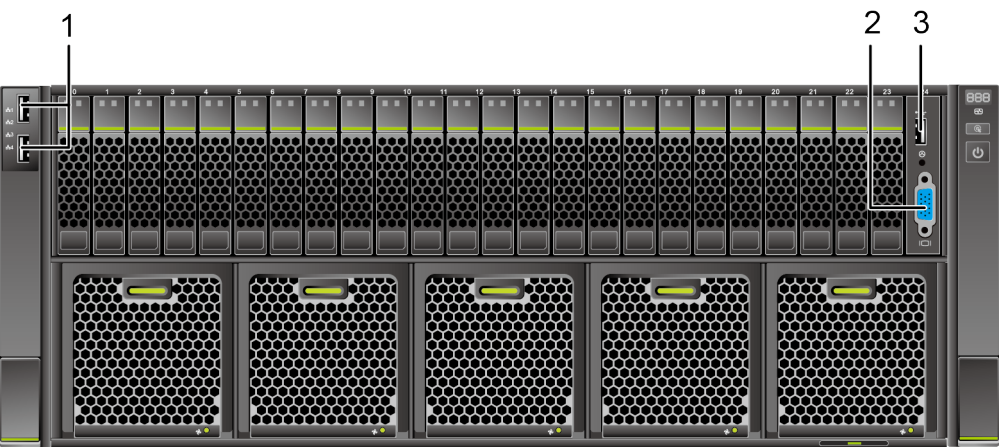
图 5-7 前面板接口



1	USB 2.0接口	2	USB 3.0接口
3	VGA (Video Graphic Array) 接口	-	-

- 24x2.5英寸硬盘配置（16xSAS/SATA+8xNVMe、24xSAS/SATA）

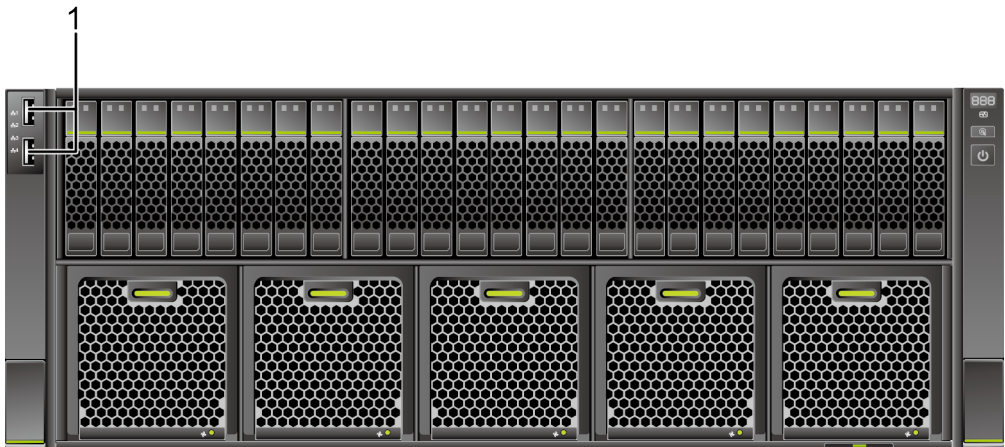
图 5-8 前面板接口



1	USB 2.0接口	2	VGA接口
3	USB 3.0接口	-	-

- 25x2.5英寸SAS/SATA硬盘配置

图 5-9 前面板接口



1	USB 2.0接口	-	-
---	-----------	---	---

接口说明

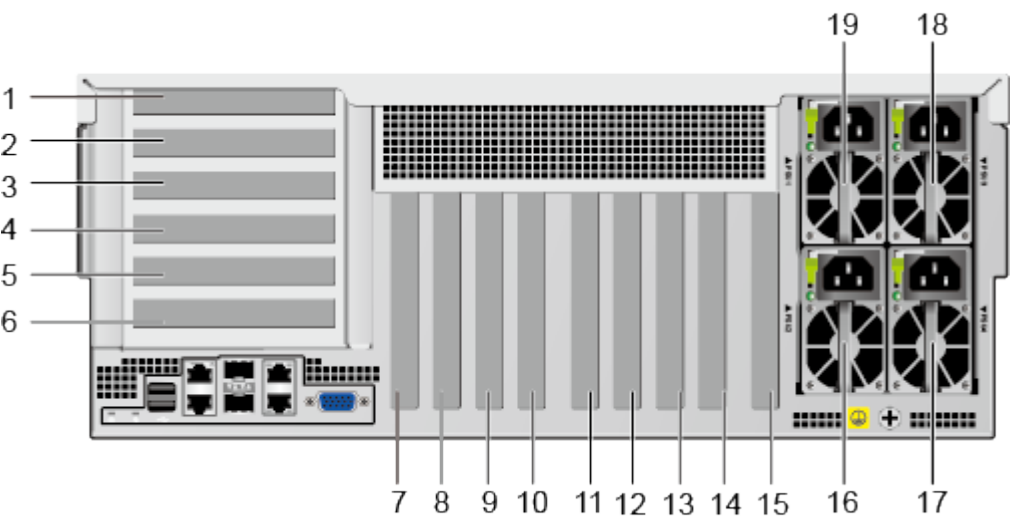
表 5-2 前面板接口说明

名称	类型	数量 ^注	说明
VGA接口	DB15	1	用于连接显示终端，例如显示器或KVM（ Keyboard, Video and Mouse ）。
USB接口	USB 2.0	2	用于接入USB设备。 须知 使用外接USB设备时，请确认USB设备状态良好，否则可能导致服务器工作异常。
	USB 3.0	1	
注：不同配置支持的接口数量可能不同，请以实际配置为准。本表是指在不同配置下，支持的最大接口数量。			

5.2 后面板

5.2.1 外观

图 5-10 后面板外观

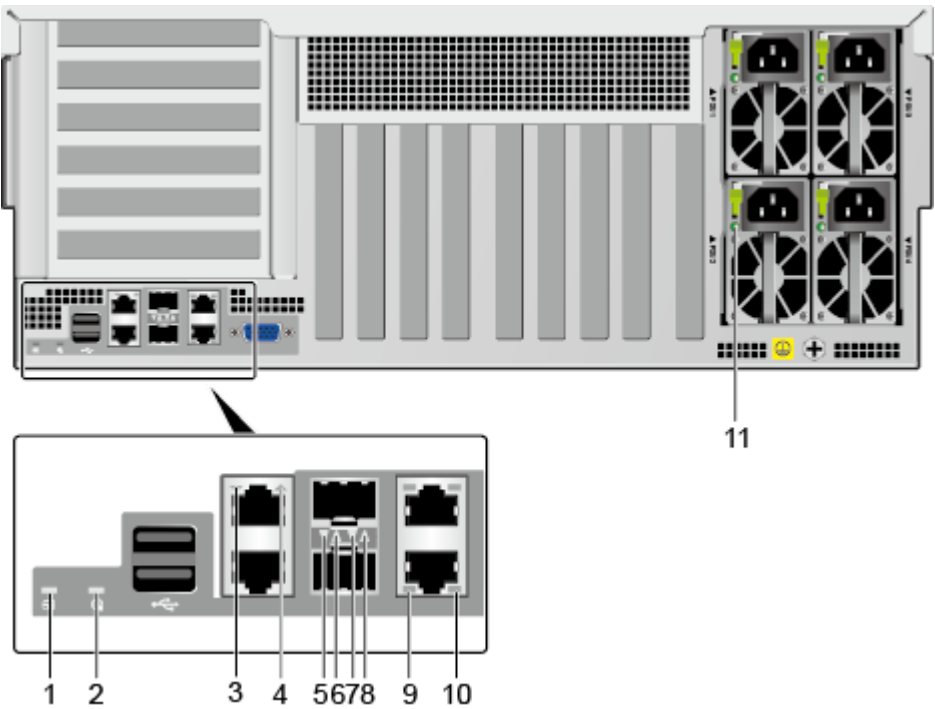


1	PCIe slot1	2	PCIe slot2
3	PCIe slot3	4	PCIe slot4
5	PCIe slot5	6	PCIe slot6
7	PCIe slot7	8	PCIe slot8
9	PCIe slot9	10	PCIe slot10
11	PCIe slot11	12	PCIe slot12
13	PCIe slot13	14	PCIe slot14
15	PCIe slot15	16	电源模块2
17	电源模块4	18	电源模块3
19	电源模块1	-	-

5.2.2 指示灯

指示灯位置

图 5-11 后面板指示灯



1	健康状态指示灯	2	UID指示灯
3	GE电口1连接状态指示灯/数据传输状态指示灯	4	GE电口2连接状态指示灯/数据传输状态指示灯
5	10GE光口4连接状态指示灯/数据传输状态指示灯	6	10GE光口3连接状态指示灯/数据传输状态指示灯
7	10GE光口4速率指示灯	8	10GE光口3速率指示灯
9	管理网口数据传输状态指示灯	10	管理网口连接状态指示灯
11	电源模块指示灯	-	-

指示灯说明

表 5-3 后面板指示灯说明

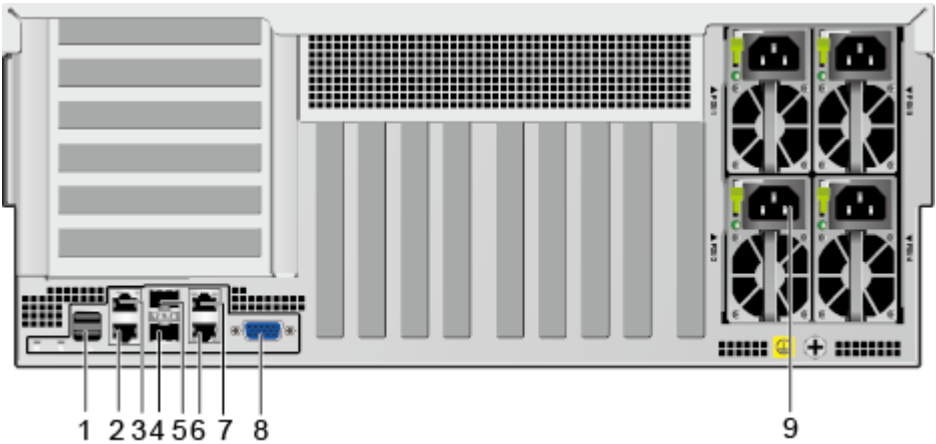
指示灯	状态说明
电源模块指示灯	● 熄灭：无电源输入。 ● 绿色闪烁（1Hz）： - 输入正常，服务器为Standby状态，电源进入MV6模式（输出电压为6.7V）。 - 输入过/欠压。 - 电源模块进入深度休眠模式。 ● 绿色闪烁（4Hz）：Firmware在线升级过程中。 ● 绿色常亮：输入和输出正常。 ● 橙色常亮：输入正常，无输出。 说明 导致无输出的可能原因： ● 电源过温保护 ● 电源输出过流/短路 ● 输出过压 ● 短路保护 ● 器件失效（不包括所有的器件失效）
UID指示灯	UID指示灯用于定位待操作的设备。 ● 熄灭：设备未被定位。 ● 蓝色闪烁：设备被重点定位。 ● 蓝色常亮：设备被定位。 说明 可通过手动按UID按钮或者iBMC命令远程控制使灯熄灭或灯亮。
健康状态指示灯	● 熄灭：设备未上电或处于异常状态。 ● 红色闪烁（1Hz）：系统有严重告警。 ● 红色闪烁（5Hz）：系统有紧急告警。 ● 绿色常亮：设备运转正常。
管理网口数据传输状态指示灯	● 熄灭：无数据传输。 ● 黄色闪烁：有数据正在传输。
管理网口连接状态指示灯	● 熄灭：网络未连接。 ● 绿色常亮：网络连接正常。
GE电口连接状态指示灯/数据传输状态指示灯	● 熄灭：网络未连接。 ● 绿色闪烁：有数据正在传输。 ● 绿色常亮：网络连接正常。

指示灯	状态说明
10GE光口连接状态指示灯/数据传输状态指示灯	- 熄灭：网络未连接。 - 绿色闪烁：有数据正在传输。 - 绿色常亮：网络连接正常。
10GE光口速率指示灯	- 熄灭：网络未连接。 - 绿色常亮：数据传输速率为10Gbit/s。 - 黄色常亮：数据传输速率为10Gbit/s以外的其它速率。

5.2.3 接口

接口位置

图 5-12 后面板接口



1	USB 3.0接口	2	GE电口（板载网口2）
3	GE电口（板载网口1）	4	10GE光口（板载网口4）
5	10GE光口（板载网口3）	6	管理网口
7	串口	8	VGA接口
9	电源模块接口	-	-

接口说明

表 5-4 后面板接口说明

名称	类型	数量	说明
10GE光口	10GE SFP+	2	板载10GE业务网口（光口）。
GE电口	1000BASE-T	2	板载GE业务网口（电口）。
VGA接口	DB15	1	用于连接显示终端，例如显示器或KVM（Keyboard, Video and Mouse）。
串口	RJ45	1	用于调试，默认为系统串口，可通过命令行设置为iBMC串口。 说明 通讯标准为三线制串口，波特率默认为115200bit/s。
管理网口	1000BASE-T	1	用于管理服务器。 说明 管理网口为千兆网口，速率支持100/1000M自适应。
USB接口	USB 3.0	2	用于接入USB设备。 须知 使用外接USB设备时，请确认USB设备状态良好，否则可能导致服务器工作异常。
电源模块接口	-	4	用于连接PDU，用户可根据需要选择电源模块数量。 说明 - 选择电源模块数量时，必须确保电源的额定功率大于整机额定功率。 - 采用单电源模块供电时，在iBMC Web界面中的“电源预期状态”，不能设置为“主备供电”。

表 5-5 板载网卡网口说明

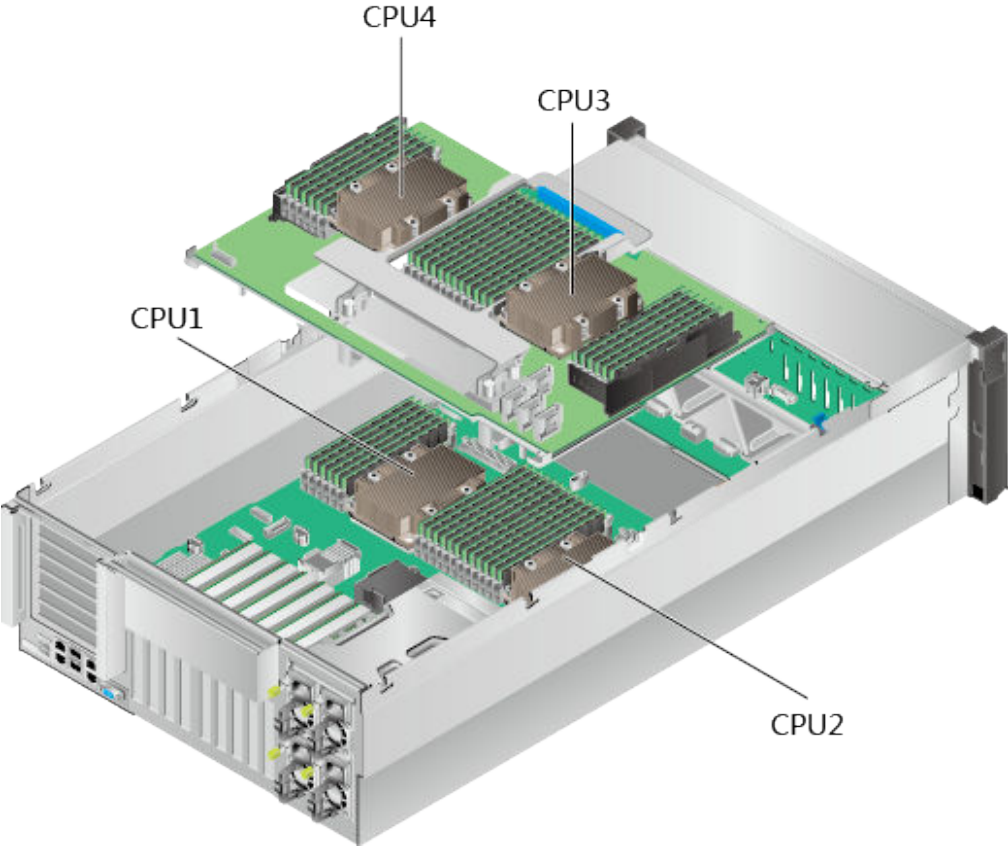
芯片型号	网口	速率协商模式	支持的速率	不支持的速率
X722	10GE光口	自协商 10000M Full	10000M	10/100/1000M
	GE电口	自协商1000M Full	1000M	10/100M

芯片型号	网口	速率协商模式	支持的速率	不支持的速率
- 板载网口支持的线缆和光模块，详细信息请参见智能计算产品兼容性查询助手。 - 板载网口支持NC-SI、PXE功能。 - 板载网口不支持强制速率。 - 板载网口（电口）不支持与POE供电设备（例如打开POE功能的POE交换机）对接，强行对接存在链路通信异常甚至损坏网卡的风险。 - 板载网口（电口）不支持SR-IOV特性。 - 强制下电服务器时，会导致板载网口的NC-SI闪断，需要重新刷新iBMC界面恢复，同时还会导致板载网口WOL功能失效。				

5.3 处理器

- 支持2个或4个处理器。
- 配置2个处理器时，需要安装在CPU1和CPU2位置。
- 配置在同一服务器的处理器，型号必须相同。
- 具体可选购的系统选件，请咨询华为当地销售代表或参见[智能计算产品兼容性查询助手](#)。

图 5-13 处理器位置

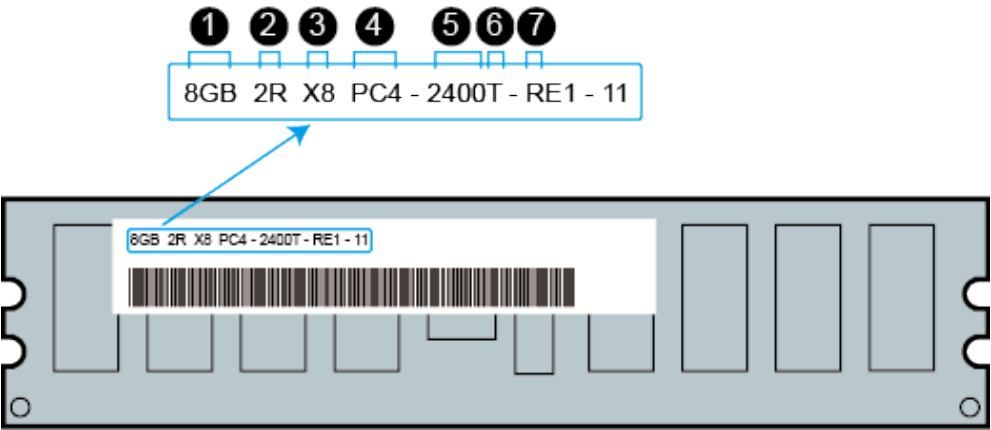


5.4 内存

5.4.1 内存标识

要确定内存特性，请参阅内存上粘贴的标签以及下面的插图和表格。

图 5-14 内存标识



序号	说明	定义
1	容量	• 8 GB • 16 GB • 32 GB • 64 GB • 128 GB
2	列（Rank）	• 1R = 单列 • 2R = 双列 • 4R = 四列 • 8R = 八列
3	DRAM上的数据宽度	• X4 = 4位 • X8 = 8位
4	内存接口类型	• PC3 = DDR3 • PC4 = DDR4
5	最大内存速度	• 2133MT/S • 2400MT/S • 2666MT/S • 2933MT/S

序号	说明	定义
6	CAS延迟时间	• P=15 • T=17
7	DIMM类型	• R = RDIMM（寄存） • L = LRDIMM（负载降低）

5.4.2 内存子系统体系结构

5885H V5提供48个内存接口，每个处理器内部集成了6个内存通道。

在各内存通道的内存插槽安装内存时，需要先安装主内存通道的内存。如果主内存通道没有安装内存，则备通道的内存无法正常使用。

表 5-6 通道组成

通道归属	通道	组成
CPU1	A通道（主）	DIMM000(A)
	A通道	DIMM001(G)
	B通道（主）	DIMM010(B)
	B通道	DIMM011(H)
	C通道（主）	DIMM020(C)
	C通道	DIMM021(I)
	D通道（主）	DIMM030(D)
	D通道	DIMM031(J)
	E通道（主）	DIMM040(E)
	E通道	DIMM041(K)
	F通道（主）	DIMM050(F)
	F通道	DIMM051(L)
CPU2	A通道（主）	DIMM100(A)
	A通道	DIMM101(G)
	B通道（主）	DIMM110(B)
	B通道	DIMM111(H)
	C通道（主）	DIMM120(C)
	C通道	DIMM121(I)
	D通道（主）	DIMM130(D)

通道归属	通道	组成
	D通道	DIMM131(J)
	E通道（主）	DIMM140(E)
	E通道	DIMM141(K)
	F通道（主）	DIMM150(F)
	F通道	DIMM151(L)
CPU3	A通道（主）	DIMM200(A)
	A通道	DIMM201(G)
	B通道（主）	DIMM210(B)
	B通道	DIMM211(H)
	C通道（主）	DIMM220(C)
	C通道	DIMM221(I)
	D通道（主）	DIMM230(D)
	D通道	DIMM231(J)
	E通道（主）	DIMM240(E)
	E通道	DIMM241(K)
	F通道（主）	DIMM250(F)
	F通道	DIMM251(L)
CPU4	A通道（主）	DIMM300(A)
	A通道	DIMM301(G)
	B通道（主）	DIMM310(B)
	B通道	DIMM311(H)
	C通道（主）	DIMM320(C)
	C通道	DIMM321(I)
	D通道（主）	DIMM330(D)
	D通道	DIMM331(J)
	E通道（主）	DIMM340(E)
	E通道	DIMM341(K)
	F通道（主）	DIMM350(F)
	F通道	DIMM351(L)

5.4.3 内存兼容性信息

在选择DDR4内存时，可参考以下规则进行配置：

须知

- 同一台服务器必须使用相同型号的DDR4内存，且全部内存的运行速度均相同，速度值为以下各项的最低值：
 - 特定CPU支持的内存速度。
 - 特定内存配置最大工作速度。
 - 不同类型（RDIMM、LRDIMM）和不同规格（容量、位宽、rank、高度等）的DDR4内存不支持混合使用。
 - 具体可选购的系统选件，请咨询华为当地销售代表或参见[智能计算产品兼容性查询助手](#)。
-
- 支持搭配英特尔®至强®可扩展处理器（Skylake, Cascade Lake）使用，不同型号的CPU支持的最大内存容量不同。
 - Skylake CPU
 - M系列CPU支持内存容量1.5TB/Socket
 - 非M系列CPU支持内存容量768GB/Socket
 - Cascade Lake CPU
 - L系列CPU支持内存容量4.5TB/Socket
 - M系列CPU支持内存容量2TB/Socket
 - 其余型号CPU支持内存容量1TB/Socket
 - 支持内存总容量的计算公式如下：内存总容量等于所有DDR4内存的容量之和

须知

内存总容量不能超过CPU支持的最大内存容量。

- 支持单条内存容量的具体容量类型，详细信息请参见[智能计算产品兼容性查询助手](#)。
- 支持内存数量的最大值，取决于CPU类型、内存类型、rank数量以及工作电压。

说明

每条通道支持的rank数量（最多支持8个rank）对每条通道最多支持的内存数量有如下限制：

每条通道最多支持的内存数量 ≤ 每条通道支持的rank数量 ÷ 每条内存的rank数量

- 支持超过8个rank的低负载DIMM（LRDIMM）。

说明

1个Quad rank LRDIMM与1个Single rank RDIMM给内存总线提供相同的电力负荷。

表 5-7 DDR4 内存参数

项目		取值
单条最大支持的DDR4内存容量 (GB)		128
额定速度 (MT/s)		2933
工作电压 (V)		1.2
整机最多支持的DDR4内存数量 ^a		48
整机最大支持的DDR4内存容量 (GB) ^b		6144
最大工作速度 (MT/s)	1DPC ^c	2933 ^d
	2DPC	2666
• a: 最多支持的DDR4内存数量是基于4个处理器配置的数量, 如果是2个处理器配置, 则数量减半。 • b: 最大支持的DDR4内存容量需要考虑CPU类型, 此处最大支持的DDR4内存容量为满配内存时的数值。 • c: DPC (DIMM Per Channel), 即每条内存通道配置的内存数量。 • d: 配置Cascade Lake CPU时, 配置内存的最大工作速率可以达到2933MT/s; 配置Skylake CPU时, 配置内存的最大工作速率只能达到2666MT/s。		

5.4.4 内存安装准则

- DDR4内存的通用安装准则：
 - 仅在装有相应的处理器时安装内存。
 - 请勿混用LRDIMM和RDIMM。
 - 不安装内存时, 内存插槽需要安装假内存条。
- DDR4内存存在具体模式下的安装准则：
 - 内存备用模式安装准则
 - 遵循通用安装准则。
 - 每个通道的联机备用配置必须有效。
 - 每个通道可以具有不同的有效联机备用配置。
 - 每个安装有内存的通道都必须有备用列。
 - 内存镜像模式安装准则
 - 遵循通用安装准则。
 - 每个处理器支持两个IMC (integrated memory controller, 集成内存控制器), 每个IMC中至少两个通道安装内存, 通道1和2或通道1、2和3。安装的内存必须具有相同的大小和组织形式。
 - 在多处理器配置中, 每个处理器必须具有有效的镜像内存配置。

- 内存巡检模式安装准则
 - 遵循通用安装准则。

5.4.5 内存插槽位置

5885H V5最多可以安装48条DDR4内存，推荐使用均衡内存配置，可实现最佳内存性能。

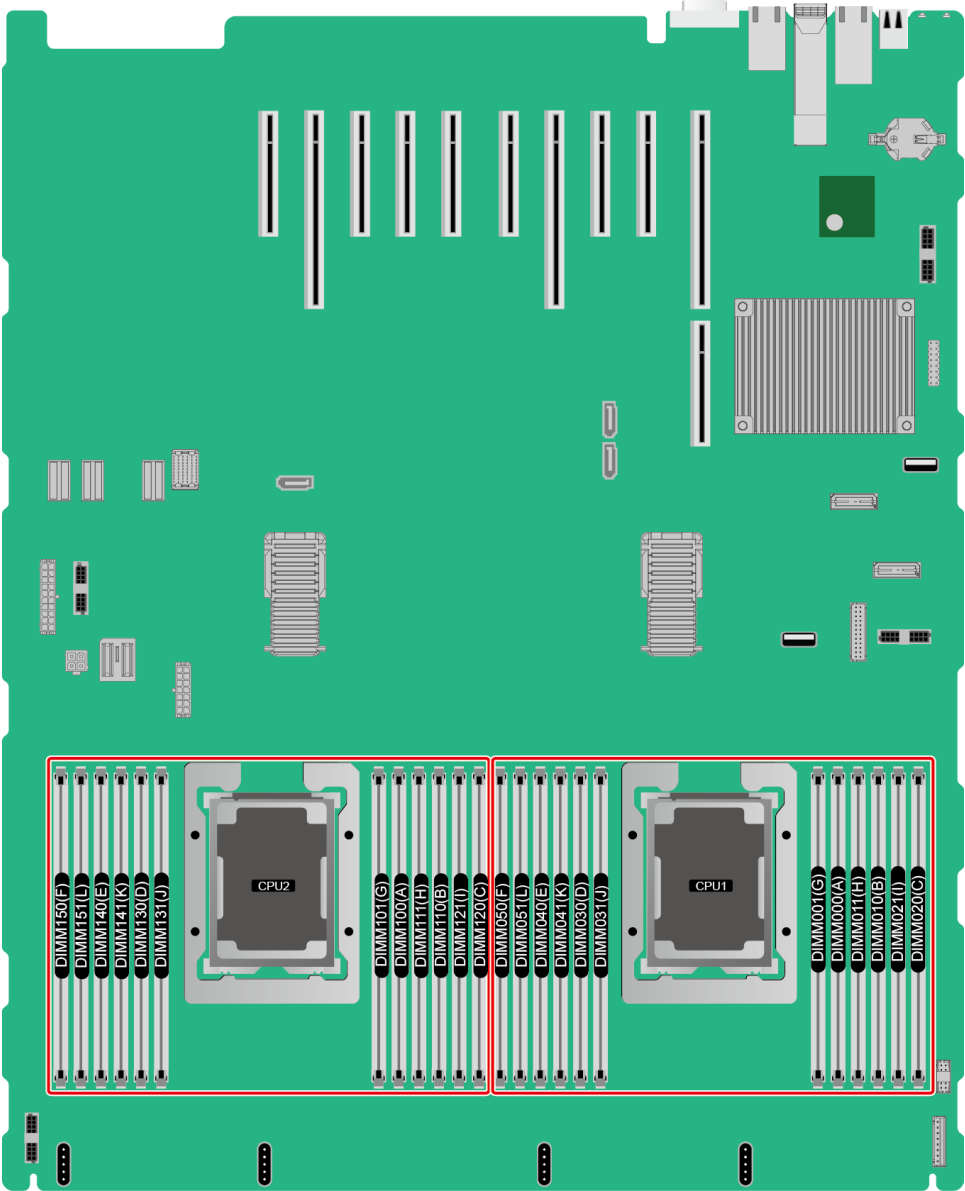
须知

CPU1对应的内存槽位上至少配置1条DDR4内存。

CPU1和CPU2位于主板上，CPU3和CPU4位于扣板上：

- 内存插槽位置（主板）

图 5-15 内存插槽位置（主板）



- 内存插槽位置（扣板）

图 5-16 内存插槽位置（扣板）

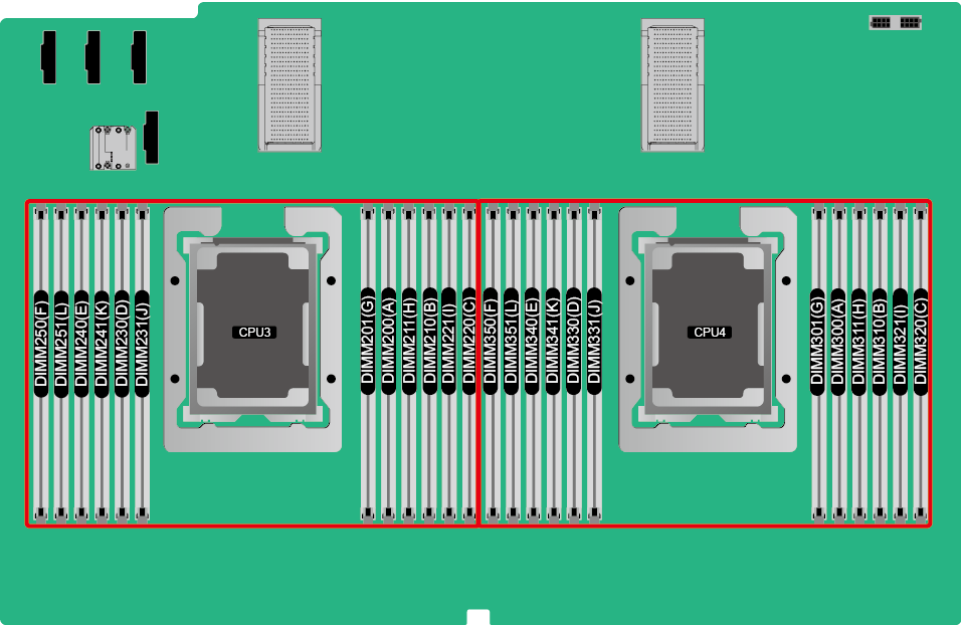


图 5-17 DDR4 内存安装原则（2 个处理器）

处理器	通道	内存的位置	内存数量 (✓：推荐 ○：不推荐)																							
			○	✓	○	✓	○	✓	○	✓	○	○	○	✓	○	○	○	✓	○	○	○	○	○	○	○	✓
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CPU1	A	DIMM000 (A)	●	●				●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		DIMM001 (G)													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	DIMM010 (B)				●	●	●	●	●		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
		DIMM011 (H)															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	C	DIMM020 (C)					●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
		DIMM021 (I)																	●	●			●	●	●	●
	D	DIMM030 (D)							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		DIMM031 (J)															●	●			●	●	●	●	●	●
	E	DIMM040 (E)							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		DIMM041 (K)																●	●			●	●	●	●	●
	F	DIMM050 (F)											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		DIMM051 (L)																	●	●					●	●
CPU2	A	DIMM100 (A)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		DIMM101 (G)															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	DIMM110 (B)				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		DIMM111 (H)																●	●	●	●	●	●	●	●	●
	C	DIMM120 (C)						●	●			●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●
		DIMM121 (I)																	●	●			●	●	●	●
	D	DIMM130 (D)							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		DIMM131 (J)																●	●			●	●	●	●	●
	E	DIMM140 (E)							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		DIMM141 (K)																	●	●			●	●	●	●
	F	DIMM150 (F)												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		DIMM151 (L)																							●	●

[illegible]

- ECC
- Full Mirror
- Address Range Mirror
- SDDC
- SDDC+1
- Rank Sparring Mode
- Static Virtual Lockstep
- Failed DIMM Isolation
- Memory Thermal Throttling
- Memory Address Parity Protection
- Memory Demand/Patrol Scrubbing
- Device Tagging

- Data Scrambling
- ADDDC
- ADDDC+1

5.5 存储

5.5.1 硬盘配置

表 5-8 硬盘配置

配置	最大前置硬盘（个）	硬盘管理方式
8x2.5英寸SAS/SATA硬盘配置	8 • 槽位0至槽位7只支持SAS/SATA硬盘	1xRAID控制卡
24x2.5英寸SAS/SATA硬盘配置	24 • 槽位0至槽位23只支持SAS/SATA硬盘	3xRAID控制卡
24x2.5英寸硬盘配置 (16xSAS/SATA+8xNVMe)	24 • 槽位0至槽位3、槽位20至槽位23只支持NVMe硬盘 • 槽位4至槽位19只支持SAS/SATA硬盘	1xRAID控制卡+2xNVMe转接卡
25x2.5英寸SAS/SATA硬盘配置	25 • 槽位0至槽位24只支持SAS/SATA硬盘	1xRAID控制卡
• a: 前置硬盘（槽位0至槽位3）配置SAS/SATA硬盘时，才需要配置1张RAID控制卡。 • 具体可选购的系统选件，请咨询华为当地销售代表或参见智能计算产品兼容性查询助手。		

5.5.2 硬盘编号

- 8x2.5英寸SAS/SATA硬盘配置

图 5-19 硬盘编号



- 24x2.5英寸硬盘配置（16xSAS/SATA+8xNVMe、24xSAS/SATA）

图 5-20 硬盘编号



- 25x2.5英寸SAS/SATA硬盘配置

图 5-21 硬盘编号



5.5.3 硬盘指示灯

SAS/SATA 硬盘指示灯

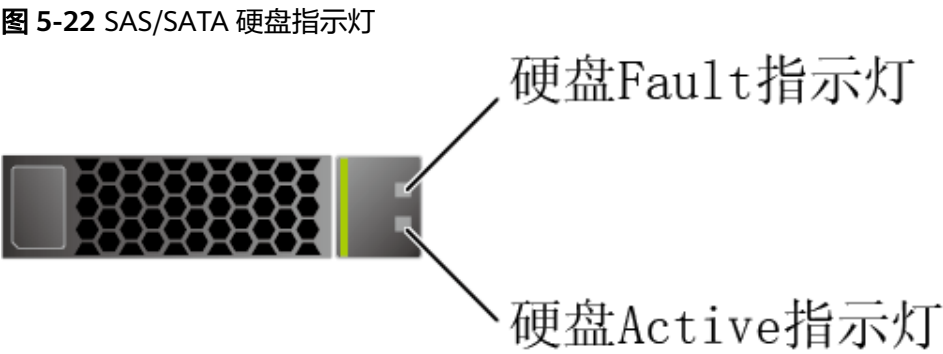


表 5-9 SAS/SATA 硬盘指示灯说明

硬盘Active指示灯 (绿色)	硬盘Fault指示灯 (黄色)	状态说明
常亮	熄灭	硬盘在位。
闪烁 (4Hz)	熄灭	硬盘处于正常读写状态或重构主盘状态。
常亮	闪烁 (1Hz)	硬盘被定位。
闪烁 (1Hz)	闪烁 (1Hz)	硬盘处于重构从盘状态。
熄灭	常亮	RAID组中硬盘被拔出。
常亮	常亮	硬盘故障。

NVMe 硬盘指示灯

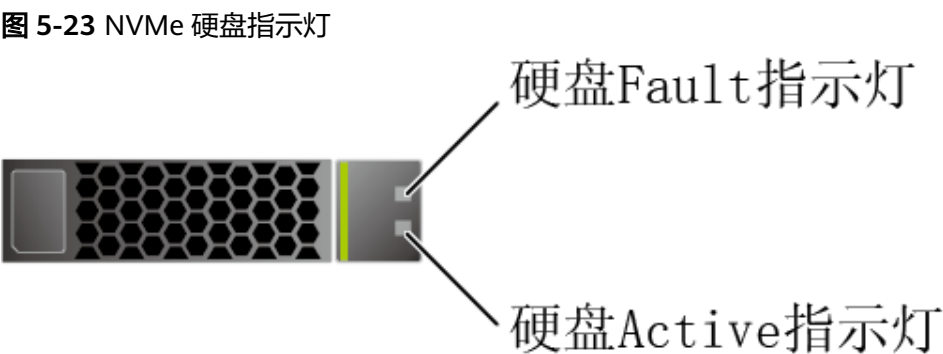


表 5-10 NVMe 硬盘指示灯说明（NVMe 硬盘仅支持通知式热插拔）

硬盘Active指示灯 (绿色)	硬盘Fault指示灯 (黄色)	状态说明
熄灭	熄灭	NVMe硬盘不在位。
常亮	熄灭	NVMe硬盘在位且无故障。
闪烁（2Hz）	熄灭	NVMe硬盘正在进行读写操作。
熄灭	闪烁（2Hz）	NVMe硬盘被定位或正处于热插过程中。
熄灭	闪烁（0.5Hz）	NVMe硬盘已完成热拔出流程，允许拔出。
常亮/熄灭	常亮	NVMe硬盘故障。

5.5.4 RAID 控制卡

RAID控制卡提供RAID支持、RAID级别迁移、磁盘漫游等功能。

- 具体可选购的系统选件，请咨询华为当地销售代表或参见[智能计算产品兼容性查询助手](#)。
- 关于RAID控制卡的详细信息，请参见《[华为V5服务器 RAID控制卡 用户指南](#)》。

5.6 IO 扩展

5.6.1 PCIe 卡

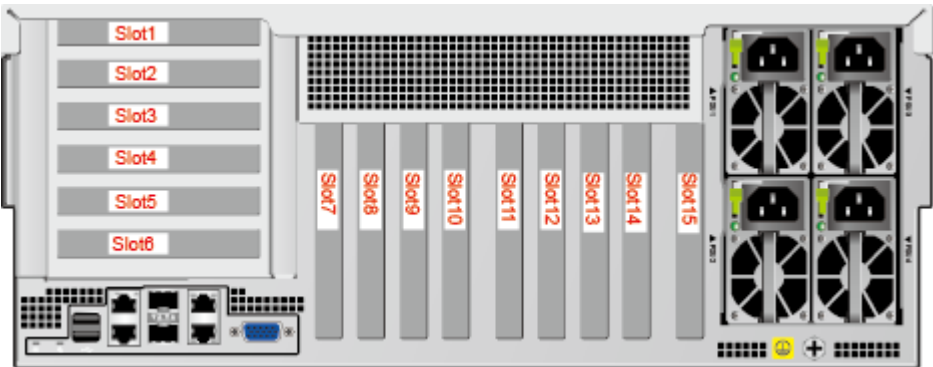
PCIe卡提供系统扩展能力。

- 具体可选购的系统选件，请咨询华为当地销售代表或参见[智能计算产品兼容性查询助手](#)。

5.6.2 PCIe 插槽

PCIe 插槽位置

图 5-24 PCIe 插槽



- Slot1至Slot6为PCIe Riser模组提供的槽位。
- Slot7至Slot15为主板上提供的槽位。

5.6.3 PCIe 插槽说明

说明

当CPU3、CPU4不在位时，其对应的PCIe插槽不可用。

表 5-11 PCIe 插槽说明

PCIe槽位	从属CPU	PCIe标准	连接器带宽	总线带宽	端口号	B/D/F	槽位大小
板载网卡	CPU1	PCIe 3.0	-	x4	Port2D	0x24/0x03/0x00	-
Slot1	CPU3	PCIe 3.0	x8	x4	Port1A	0x83/0x00/0x00	全高全长
Slot2	CPU3	PCIe 3.0	x16	x16	Port3A	0xB1/0x00/0x00	全高全长
Slot3	CPU3	PCIe 3.0	x8	x4	Port1B	0x83/0x00/0x08	全高全长
Slot4	CPU1	PCIe 3.0	x16	X16	Port3A	0x32/0x00/0x00	全高全长
Slot5	CPU3	PCIe 3.0	x8	x8	Port1C	0x83/0x00/0x10	全高半长
Slot6	CPU4	PCIe 3.0	x8	x8	Port2A	0xE2/0x00/0x00	全高半长
Slot7	CPU1	PCIe 3.0	x8	x4	Port2C	0x24/0x00/0x10	全高半长
Slot8	CPU1	PCIe 3.0	x8	x8	Port2A	0x24/0x00/0x00	全高半长
Slot9	CPU1	PCIe 3.0	x16	x16	Port1A	0x08/0x00/0x00	全高半长
Slot10	CPU2	PCIe 3.0	x8	x8	Port2C	0x62/0x00/0x10	全高半长
Slot11	CPU2	PCIe 3.0	x8	x8	Port2A	0x62/0x00/0x00	全高半长
Slot12	CPU2	PCIe 3.0	x8	x8	Port1A	0x43/0x00/0x00	全高半长
Slot13	CPU3	PCIe 3.0	x8	x8	Port2A	0xA2/0x00/0x00	全高半长

PCIe槽位	从属CPU	PCIe标准	连接器带宽	总线带宽	端口号	B/D/F	槽位大小
Slot14	CPU2	PCIe 3.0	x16	x16	Port3A	0x71/0x00/0x00	全高半长
Slot15	CPU2	PCIe 3.0	x8	x8	Port1C	0x43/0x00/0x10	全高半长
- 表格中的B/D/F（Bus/Device/Function Number）数据是PCIe部件满配时的默认取值，PCIe卡不满配或配置带PCI bridge的PCIe卡时，B/D/F可能会改变。 - 总线带宽为PCIe x16的插槽向下兼容PCIe x8、PCIe x4、PCIe x1的PCIe卡。向上则不兼容，即PCIe插槽的带宽不能小于插入的PCIe卡的带宽。 - 槽位大小为全高半长的PCIe插槽向下兼容半高半长的PCIe卡。 - 所有槽位的供电能力都可以支持最大75W的PCIe卡，PCIe卡的功率取决于PCIe卡的型号。							

5.7 电源

- 支持2个或4个电源模块。
- 支持交流或直流电源模块。
- 支持热插拔。
- 配置2个电源模块时，支持1+1冗余备份。

📖 说明

当服务器的输出功率小于单个电源模块的额定输出功率时，支持1+1冗余备份。

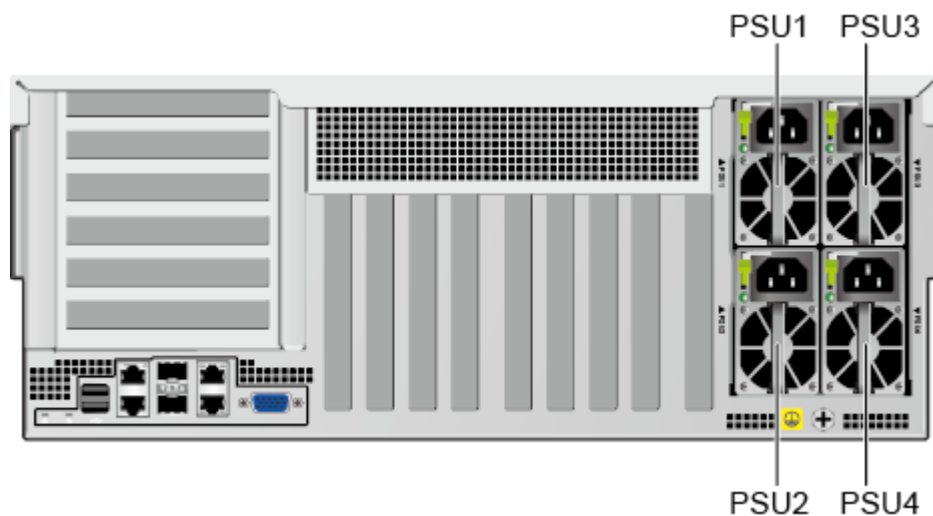
- 配置4个电源模块时，支持2+2冗余备份。
- 配置在同一服务器的电源模块，电源模块型号必须相同。
- 提供短路保护，支持双火线输入的电源模块提供双极保险。
- 具体的可选购系统选件，请咨询华为当地销售代表或参见[智能计算产品兼容性查询助手](#)。

📖 说明

配置1500W AC白金电源时：

- 当输入电压为100V AC~132V AC时，输出功率会降到1000W。
- 当配置2个1500W AC白金电源时，可以当做1700W AC电源使用。

图 5-25 电源位置



5.8 风扇

- 支持5个风扇模块。
- 支持热插拔。
- 支持单风扇失效。
- 支持可变的风扇速度。
- 配置在同一服务器的风扇模块，风扇模块型号必须相同。

图 5-26 风扇位置

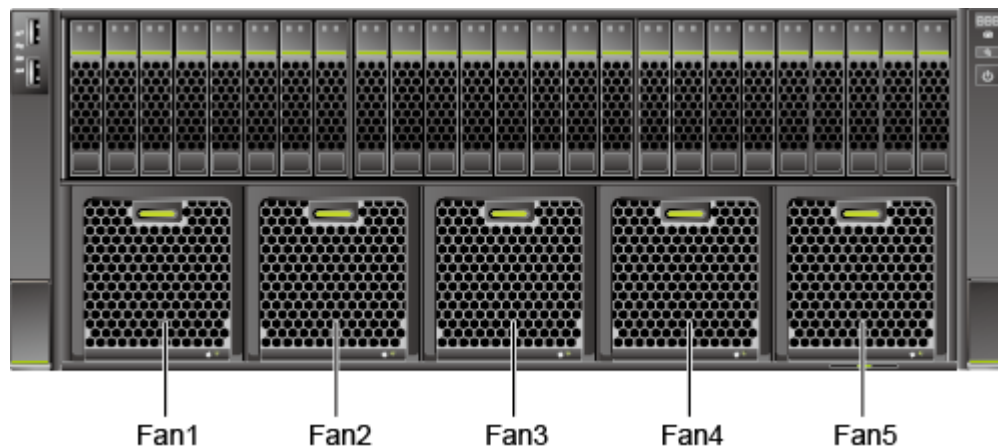
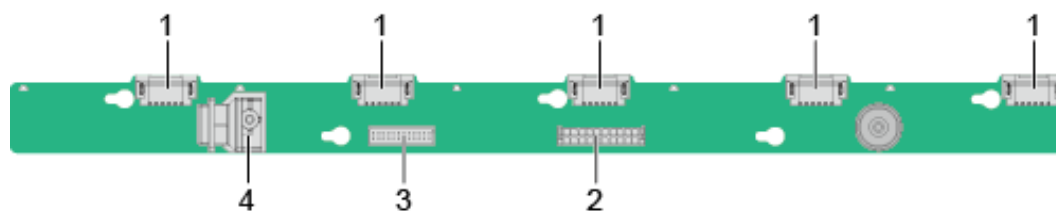


图 5-27 风扇转接板布局



1	风扇连接器	2	风扇转接板电源连接器
3	风扇转接板信号连接器	4	转接板卡扣

5.9 LCD 模块

功能

LCD模块主要用于反映服务器各部件的在位和运行状态，以及可以用于设置服务器iBMC管理网口的IP地址。

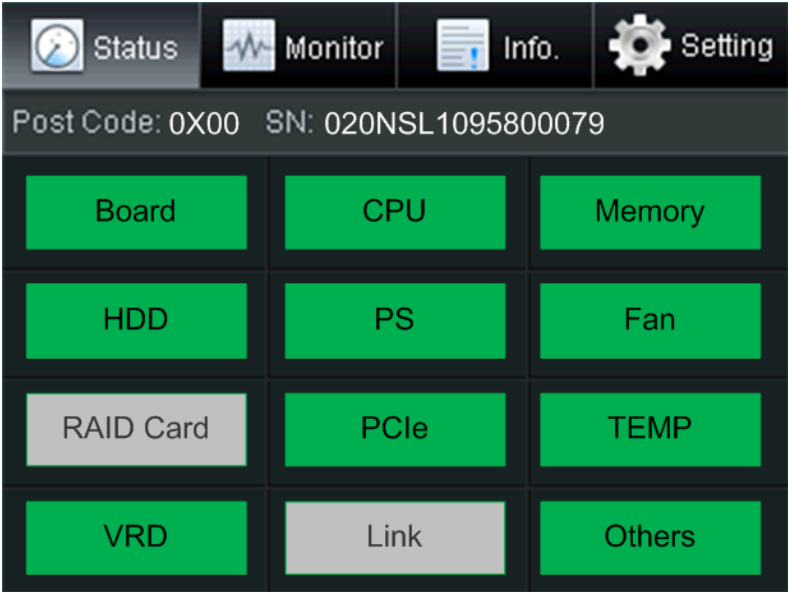
LCD模块与服务器上的iBMC管理模块共同构成LCD子系统。LCD直接从iBMC管理模块获取设备信息。LCD子系统不存储设备数据。

图 5-28 LCD 子系统工作原理



界面

图 5-29 LCD 模块界面



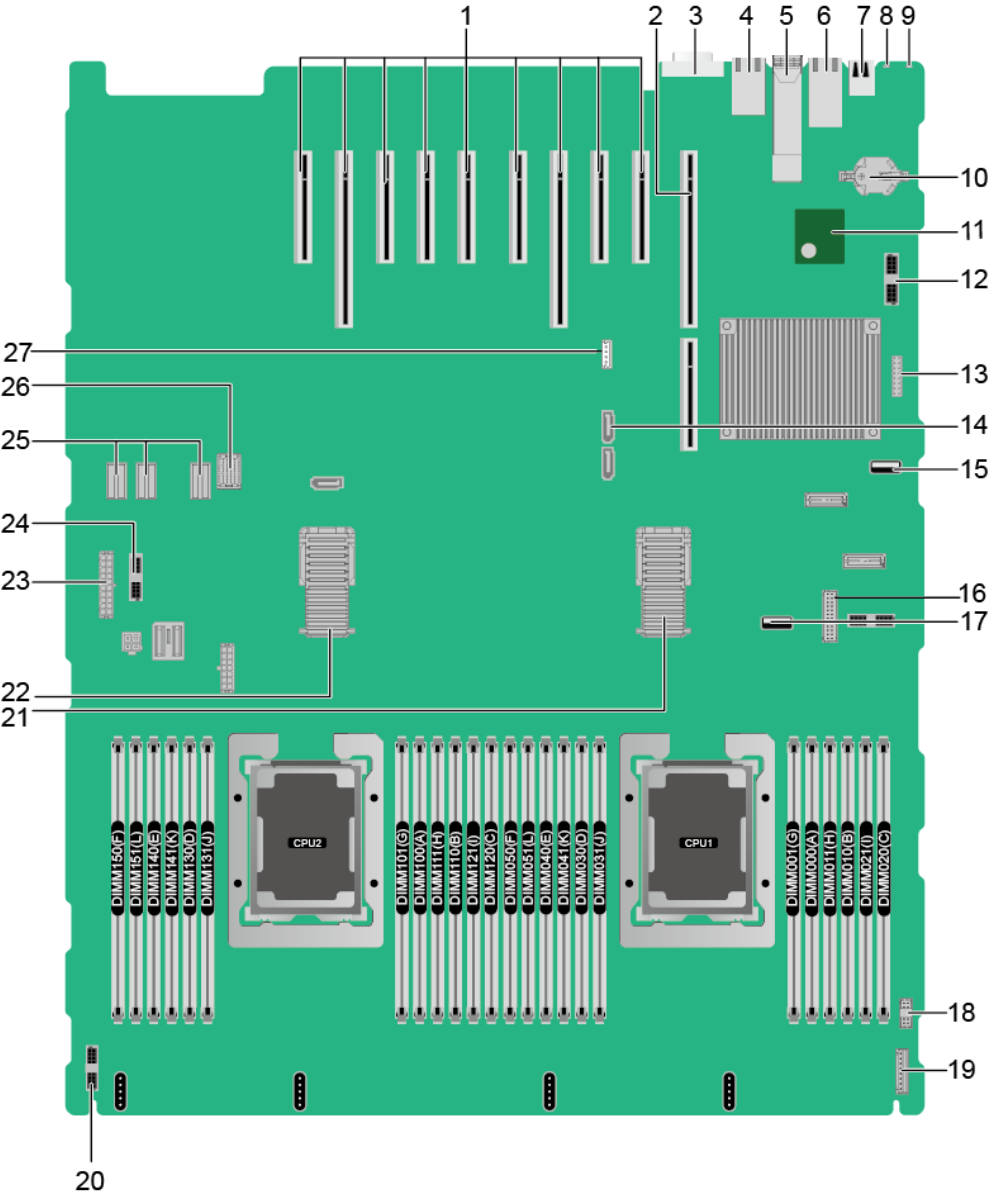
页签	功能
Status	显示服务器的80端口状态、序列号、各部件的状态及其告警信息。
Monitor	显示服务器的当前功率、CPU温度、进风口温度。
Info.	显示iBMC管理网口的IP地址和MAC（Media Access Control）地址、主机板载网口的MAC地址、设备序列号、资产信息和固件版本号。
Setting	设置iBMC管理网口的IP地址。

LCD模块的使用方法，详细信息请参见《[5885H V5 服务器 V100R005 液晶显示屏 用户指南](#)》。

5.10 单板

5.10.1 主板

图 5-30 5885H V5 主板



1	PCIe卡槽位（从右到左依次为槽位7至槽位15）	2	PCIe Riser插槽（J207对应CPU1，J230对应CPU4）
3	VGA连接器（VGA CONN/J169）	4	系统串口和管理网口（J242） ^a
5	10GE光口（10GE PORT0&PORT1/J140）	6	GE电口（GE PORT2&PORT3/J138）
7	USB 3.0接口（REAR USB3.0/J172）	8	UID指示灯

9	健康状态指示灯	10	系统电池 (U4042)
11	TPM扣卡接口 (TPM CONN/J55)	12	右挂耳连接器 (J131)
13	跳线 (J93) ^b	14	SATA DVD光驱接口 (J130)
15	USB 3.0接口 (FRONT USB3.0/J190) ^c	16	风扇转接板信号连接器 (J249)
17	USB 3.0接口 (INNER USB3.0/J182)	18	VGA连接器 (J233)
19	LCD屏连接器 (LCD CONN/J87)	20	硬盘背板信号连接器 (HDD BP/J235)
21	高速背板连接器 (J244) ^d	22	高速背板连接器 (J243) ^d
23	硬盘背板电源连接器 (BP PWR/J237)	24	左挂耳连接器 (LEFT EAR CONN BOARD/J115)
25	电源背板电源连接器 (J225/J226/J239)	26	电源背板信号连接器 (J238)
27	VROC key接口 (J144) ^e	-	-
• a: 上层RJ45对应系统串口; 下层RJ45对应管理网口。 • b: BMC_SER_MANUAL PIN针用于切换服务器物理串口连接方向; CLEAR_BMC_PW PIN针用于恢复iBMC默认配置。 • c: 内置USB 3.0接口可以通过USB线缆, 引出前置USB 3.0接口。当引出前置USB 3.0接口后, 该接口不可直接使用。 • d: CPU1和CPU2位于主板上, CPU3和CPU4位于扣板上, 主板和扣板通过高速背板连接器相连接对外提供4个CPU。 • e: 预留接口, 暂不可用。			

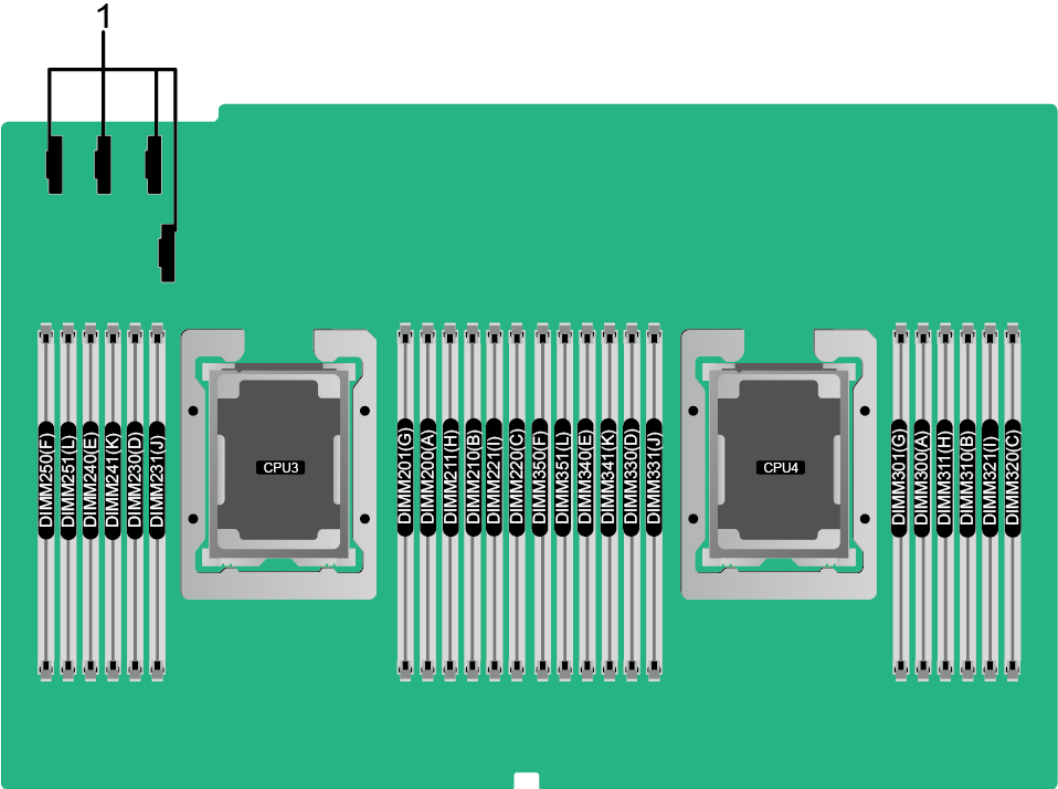
5.10.2 扣板

5885H V5的扣板如**图5-31**所示, 扣板和主板的连接关系如**图5-32**所示。

说明

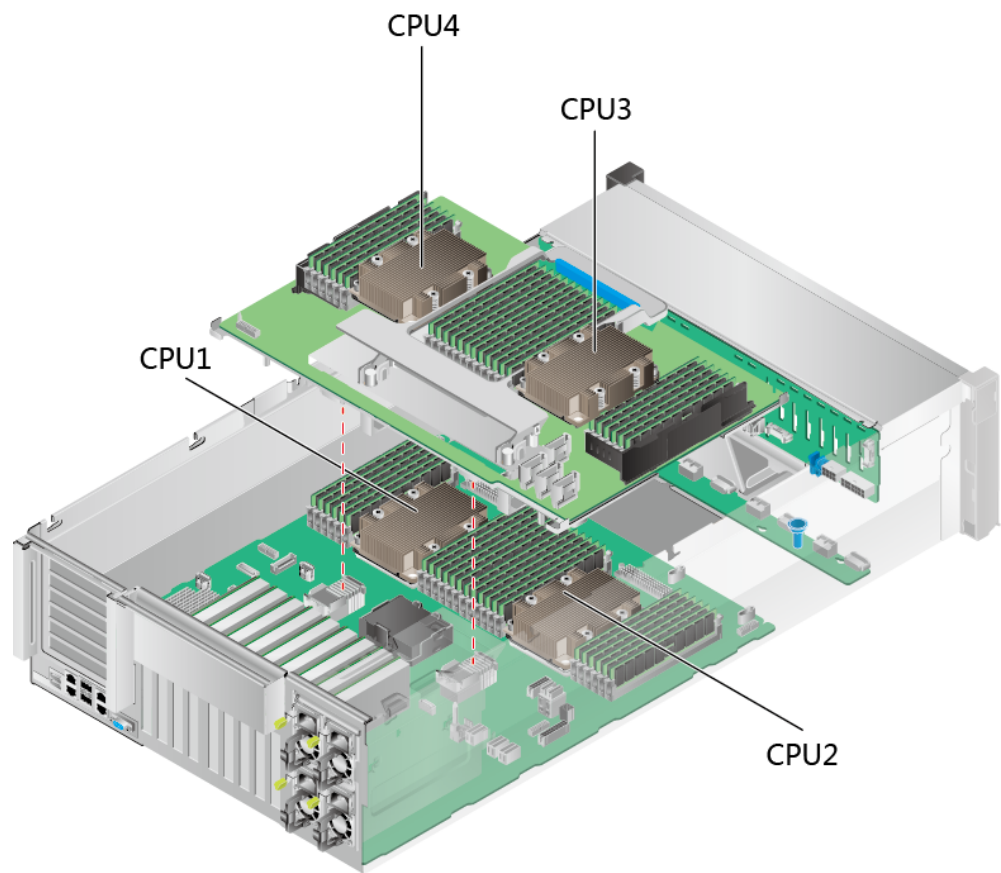
CPU1和CPU2位于主板上, CPU3和CPU4位于扣板上, 主板和扣板通过高速背板连接器相连接对外提供4个CPU。

图 5-31 扣板



1	扣板到Riser卡Slimline连接器	-	-
---	----------------------	---	---

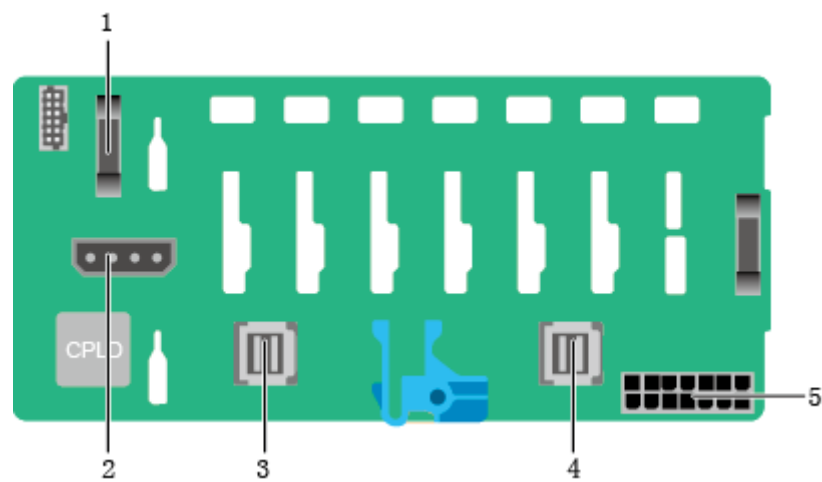
图 5-32 主板和扣板的连接关系



5.10.3 硬盘背板

- 8x2.5英寸SAS/SATA硬盘配置背板

图 5-33 8x2.5 英寸 SAS/SATA 硬盘配置背板

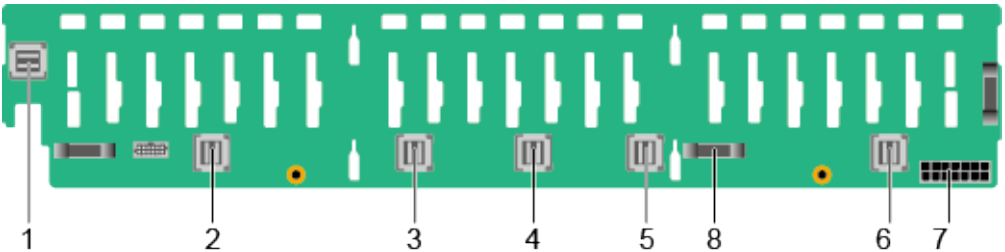


1	信号连接器（J1）	2	光驱电源连接器（J11）
---	-----------	---	--------------

3	SAS线连接器（ PORT B/ J29 ）	4	SAS线连接器（ PORT A/ J28 ）
5	背板电源连接器（ J24 ）	-	-

- 24x2.5英寸SAS/SATA硬盘配置背板

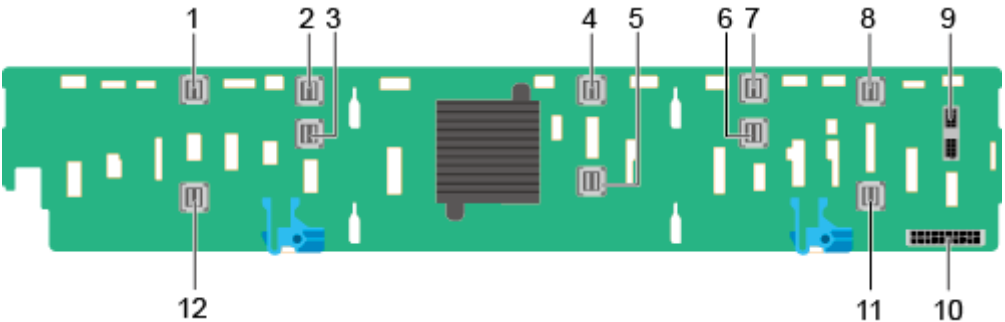
图 5-34 24x2.5 英寸 SAS/SATA 硬盘配置背板



1	SAS线连接器（ PORT 3B/ J33 ）	2	SAS线连接器（ PORT 3A/ J39 ）
3	SAS线连接器（ PORT 2B/ J31 ）	4	SAS线连接器（ PORT 2A/ J30 ）
5	SAS线连接器（ PORT 1B/ J29 ）	6	SAS线连接器（ PORT 1A/ J28 ）
7	背板电源连接器（ J24 ）	8	背板信号连接器（ J1 ）

- 24x2.5英寸硬盘配置（ 16xSAS/SATA+8xNVMe ）背板

图 5-35 24x2.5 英寸硬盘配置（ 16xSAS/SATA+8xNVMe ）背板

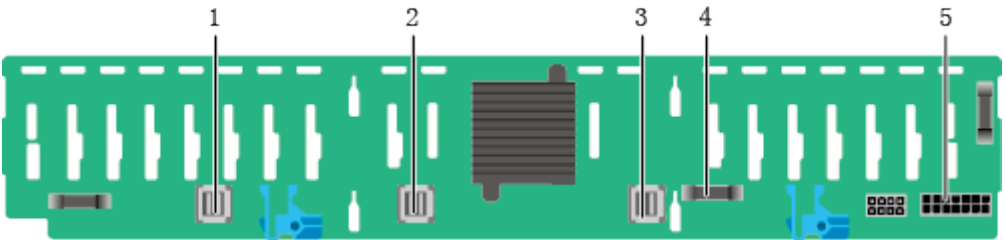


1	NVMe（ PORT B_N2/ J26 ）	2	NVMe（ PORT B_N0/ J24 ）
3	NVMe（ PORT B_N1/ J25 ）	4	SAS线连接器（ PORT C_0/J28 ）
5	SAS线连接器（ PORT C_1/J29 ）	6	NVMe（ PORT A_N1/ J21 ）

7	NVMe (PORT A_N0/ J20)	8	NVMe (PORT A_N2/ J22)
9	背板信号线连接器 (J1)	10	背板电源连接器 (J3)
11	NVMe (PORT A_N3/ J23)	12	NVMe (PORT B_N3/ J27)

- 25x2.5英寸SAS/SATA硬盘配置背板

图 5-36 25x2.5 英寸 SAS/SATA 硬盘配置背板



1	SAS线连接器 (PORT A/ J28)	2	SAS线连接器 (PORT B/ J29)
3	SAS线连接器 (REAR PORT/J31)	4	背板信号线连接器 (J1)
5	背板电源连接器 (J24)	—	—

6 产品规格

- 6.1 技术规格
- 6.2 环境规格
- 6.3 物理规格

6.1 技术规格

表 6-1 技术规格

组件	规格
形态	4U机架服务器
芯片组	Intel® C622
处理器	支持2个或4个处理器。 • 支持英特尔®至强®可扩展处理器（Skylake，Cascade Lake）。 • 处理器集成内存控制器，支持6个内存通道。 • 处理器集成PCIe控制器，支持PCIe 3.0，每个处理器提供48个lanes。 • 采用3路UPI（UltraPath Interconnect）总线互连，每路传输可达10.4GT/s。 • 最多28核（2.7GHz）。 • 最高频率为3.8GHz（4核）。 • 单核最小末级缓存为1.375MB。 • 最大热设计功率为205W。 说明 以上信息仅供参考，详细信息请参见智能计算产品兼容性查询助手。

组件	规格
内存	支持48条内存。 • 支持最多48条DDR4内存。 • 最大内存传输速率为2933MT/s。 • 支持RDIMM或LRDIMM。 • 不支持混合使用不同类型（ RDIMM、LRDIMM ）和不同规格（ 容量、位宽、rank、高度等 ）的DDR4内存。 说明 以上信息仅供参考，详细信息请参见智能计算产品兼容性查询助手。

组件	规格
存储	支持多种硬盘配置，详细信息请参见硬盘配置。 - 支持2个M.2 SSD。 - 仅配置Avago SAS3004iMR RAID控制卡时支持M.2 SSD。 - 仅当Avago SAS3004iMR RAID控制卡与SmartRAID 3152-8i/SmartHBA 2100-8i RAID控制卡搭配使用时，Avago SAS3004iMR RAID控制卡所管理的M.2 SSD才支持通过修改grub参数的方式实现OS下盘符为sda。 说明 - M.2 SSD设计仅用于安装操作系统作为Boot设备。小容量的M.2 SSD（如32GB、64GB等）耐久性（Endurance）低，不能用于Logging，如果使用小容量M.2 SSD作为Boot设备时，需要有专门的日志硬盘或者日志服务器用于Logging设备。例如，在VMware日志转存可以通过下面两种方式： - 重定向/scratch，详细信息请参见：https://kb.vmware.com/s/article/1033696 - 配置syslog，详细信息请参见：https://kb.vmware.com/s/article/2003322 - M.2 SSD的耐久性低，不能用于数据存储设备，尤其是数据擦写较大的场景下，因其在短时间内存在写穿风险，不能使用。数据存储请选用企业级DWPD较高的SSD或HDD替代。 - 写密集型业务软件将会导致M.2 SSD超出写寿命而永久损坏，这类业务场景，不推荐选择M.2 SSD。 - 禁止在Cache场景配置M.2 SSD。 - 支持SAS/SATA硬盘热插拔。 - 支持多种型号的RAID控制卡，详细信息请参见智能计算产品兼容性查询助手。 - RAID控制卡提供RAID支持、RAID级别迁移、磁盘漫游等功能。 - RAID控制卡占用一个标准PCIe槽位。 关于RAID控制卡的详细信息，请参见《华为V5服务器RAID控制卡 用户指南》。 - 支持选配SAS RAID控制卡（支持1/2/4GB cache），支持超级电容方式的掉电保护，提高硬盘存储性能，保护用户数据的安全。
网络	支持板载网卡。 - 支持主板集成2个10GE光口和2个GE电口的网卡芯片。 - 板载网口支持NC-SI、PXE功能。 说明 板载网卡提供的电口，不支持与POE供电设备（例如打开了POE功能的POE交换机）对接，强行对接存在链路通信异常甚至损坏网卡的风险。

组件	规格
IO扩展插槽	支持15个PCIe 3.0扩展槽位。 - 支持6个提升卡支持的PCIe槽位，9个板载PCIe槽位。详细信息请参见PCIe插槽和PCIe插槽说明。 - 支持华为自主开发PCIe SSD存储卡，在搜索业务、Cache业务、下载业务等应用领域可以极大的提升I/O性能。 说明 以上信息仅供参考，详细信息请参见智能计算产品兼容性查询助手。
接口	支持多种接口。 - 前面板接口： 2个USB 2.0接口 1个USB 3.0接口 1个DB15 VGA接口 说明 25x2.5英寸硬盘配置，前面板只提供2个USB 2.0接口。 - 后面板接口： 2个USB 3.0接口 1个DB15 VGA接口 1个RJ45串口 1个RJ45系统管理接口 2个GE电口 2个10GE光口 - 内置接口： 2个USB 3.0接口 说明 8x2.5英寸硬盘配置和24x2.5英寸硬盘配置，内置只提供1个USB 3.0接口。 说明 不建议在USB移动U盘上安装操作系统。
显卡	支持主板集成显卡芯片（SM750），提供32MB显存，60Hz频率下16M色彩的最大分辨率是1920x1200像素。 说明 - 仅在安装与操作系统版本配套的显卡驱动后，集成显卡才能支持1920x1200像素的最大分辨率，否则只能支持操作系统的默认分辨率。 - 配置前后VGA的机型，当只有一个VGA连接显示器时，可能会影响显示效果。
系统管理	- 支持UEFI - 支持iBMC - 支持NC-SI - 支持被第三方管理系统集成

组件	规格
安全特性	• 支持加电密码 • 支持管理员密码 • 支持TPM（国内/国外）/TCM（国内） • 支持安全启动 • 支持选配安全面板

6.2 环境规格

表 6-2 环境规格

项目	指标参数
温度	• 工作温度：5℃～45℃（41℉～113℉）（符合ASHRAE Class A2/A3/A4） • 存储温度（≤72小时）：-40℃～+65℃（-40℉～+149℉） • 长时间存储温度（>72小时）：21℃～27℃（69.8℉～80.6℉） • 最大温度变化率：20℃（36℉）/小时 说明 不同配置的工作温度规格限制不同，详细信息请参见工作温度规格限制。
相对湿度（RH，无冷凝）	• 工作湿度：8%～90% • 存储湿度（≤72小时）：5%～95% • 长时间存储湿度（>72小时）：30%～69% • 最大湿度变化率：20%/小时
风量	≥196CFM
海拔高度	• 工作海拔高度：≤3050m – 配置满足ASHRAE Class A2时，海拔高度超过900m，工作温度按每升高300m降低1℃计算。 – 配置满足ASHRAE Class A3时，海拔高度超过900m，工作温度按每升高175m降低1℃计算。 – 配置满足ASHRAE Class A4时，海拔高度超过900m，工作温度按每升高125m降低1℃计算。 • 3000m以上不支持配置机械硬盘。
腐蚀性气体污染物	腐蚀产物厚度最大增长速率： • 铜测试片：300 Å/月（满足ANSI/ISA-71.04-2013定义的气体腐蚀等级G1） • 银测试片：200 Å/月

项目	指标参数
颗粒污染物	- 符合数据中心清洁标准ISO14664-1 Class8 - 机房无爆炸性、导电性、导磁性及腐蚀性尘埃 说明 建议聘请专业机构对机房的颗粒污染物进行监测。
噪音	在工作温度23℃时，按照ISO7779（ECMA74）测试和ISO9296（ECMA109）宣称，A计权声功率LWAd（declared A-Weighted sound power levels）和A计权声压LpAm（declared average bystander position A-Weighted sound pressure levels）如下： - 空闲时： - LWAd：5.3Bels - LpAm：40.1dBA - 运行时： - LWAd：6.1Bels - LpAm：50.4dBA 说明 实际运行噪声会因不同配置、不同负载以及环境温度等因素而不同。

6.3 物理规格

表 6-3 物理规格

指标项	说明
尺寸（高×宽×深）	175mm×447mm×790mm
安装尺寸要求	- 机柜的安装要求如下： 满足IEC（International Electrotechnical Commission）297标准的通用机柜。 - 宽：482.6mm - 深：900mm以上 - 服务器导轨的安装要求如下： - L型滑道：只适用华为机柜 - 静态滑轨套件：机柜前后方孔条的距离范围为543.5mm～848.5mm - 滚珠式抽拉滑轨套件：机柜前后方孔条的距离范围为610mm～914mm

指标项	说明
满配重量	● 净重： - 8x2.5英寸硬盘配置最大重量：42Kg - 24x2.5英寸硬盘配置最大重量：44Kg - 25x2.5英寸硬盘配置最大重量：45Kg ● 包装材料重量：9Kg
能耗	不同配置（含ErP标准的配置）的能耗参数不同，详细信息请参见 智能计算产品能耗计算器 。

7 软硬件兼容性

关于操作系统以及硬件的详细信息，请参见[智能计算产品兼容性查询助手](#)。

须知

如果使用非兼容的部件，可能造成设备异常，此故障不在技术支持和保修范围内。

8 管制信息

8.1 安全

8.2 维保与保修

8.1 安全

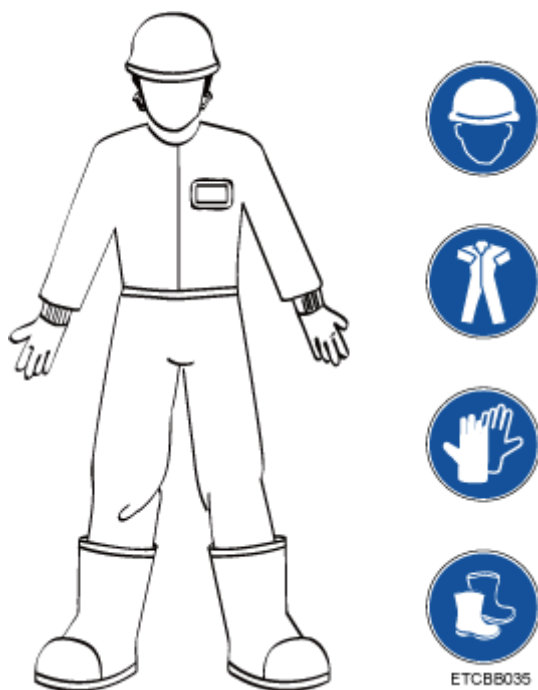
通用声明

- 操作设备时，应当严格遵守当地的法规和规范，手册中所描述的安全注意事项仅作为当地安全规范的补充。
- 手册中描述的“危险”、“警告”和“注意”事项，只作为所有安全注意事项的补充说明。
- 为保障人身和设备安全，在设备的安装过程中，请严格遵循设备上标识和手册中描述的所有安全注意事项。
- 特殊工种的操作人员（如电工、电动叉车的操作员等）必须获得当地政府或权威机构认可的从业资格证书。
- 此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

人身安全

- 设备的整个安装过程必须由通过华为认证的人员或经过华为认证人员授权的人员来完成。
- 安装人员在安装过程中，如果发现可能导致人身受到伤害或设备受到损坏时，应当立即终止操作，向项目负责人进行报告，并采取行之有效的保护措施。
- 禁止在雷雨天气进行操作，包括但不限于搬运设备、安装机柜和安装电源线等。
- 不能超过当地法律或法规所允许单人搬运的最大重量。要充分考虑安装人员当时的身体状况，务必不能超越安装人员所能承受的重量。
- 安装人员必须佩戴洁净的劳保手套、穿工作服、戴安全帽、穿劳保鞋，如图8-1所示。

图 8-1 安全防护措施



- 在接触设备前，应当穿上防静电工作服、佩戴防静电手套或防静电腕带、去除身体上携带的易导电物体（如首饰、手表等），以免被电击或灼伤，如图8-2所示。

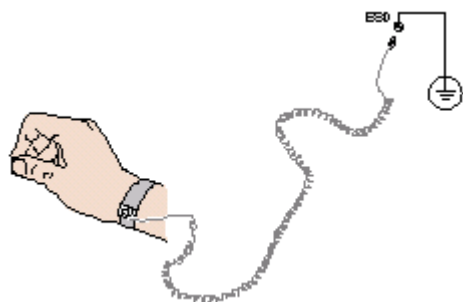
图 8-2 去除易导电的物体



佩戴防静电腕带的方法如图8-3所示。

- 将手伸进防静电腕带。
- 拉紧锁扣，确认防静电腕带与皮肤接触良好。
- 将防静电腕带的接地端插入机柜或机箱（已接地）上的防静电腕带插孔。

图 8-3 佩戴防静电腕带



- 安装人员使用工具时，务必按照正确的操作方式进行，以免危及人身安全。

- 当设备的安装位置超过安装人员的肩部时，请使用抬高车等工具辅助安装，避免设备滑落导致人员受伤或设备损坏。
- 高压电源为设备的运行提供电力，直接接触或通过潮湿物体间接接触高压电源，会带来致命危险。
- 在接通电源之前设备必须先接地，否则会危及人身安全。
- 安装人员使用梯子时，必须有专人看护，禁止单独作业，以免摔伤。
- 在连接、测试或更换光纤时，禁止裸眼直视光纤出口，以防止激光束灼伤眼睛。

设备安全

- 为了保护设备和人身安全，请使用配套的电源线缆。
- 电源线缆只能用于配套的服务器设备，禁止在其他设备上使用。
- 在接触设备前，应当穿上防静电工作服和佩戴防静电手套，防止静电对设备造成损害。
- 搬运设备时，应托住设备的底边，而不应握住设备内已安装模块（如电源模块、风扇模块、硬盘或主板）的手柄。搬运过程中注意轻拿轻放，不可重抛。
- 安装人员使用工具时，务必按照正确的操作方式进行，以免损伤设备。
- 若设备配有主备电源，为了保证设备运行的可靠性，电源线需要以主备方式连接到不同的PDU（Power Distribution Unit）上。
- 在接通电源之前设备必须先接地，否则会危及设备安全。

设备搬迁注意事项

设备搬迁过程不当易造成设备损伤，搬迁前请联系原厂了解具体注意事项。

设备搬迁包括但不限于以下注意事项：

- 雇用正规的物流公司进行设备搬迁，运输过程必须符合电子设备运输国际标准，避免出现设备倒置、磕碰、潮湿、腐蚀或包装破损、污染等情况。
- 待搬迁的设备应使用原厂包装。
- 如果没有原厂包装，机箱、刀片形态的设备等重量和体积较大的部件、光模块和PCIe（GPU或SSD）卡等易损部件需要分别单独包装。

说明

节点或服务器可支持的部件，详细信息请参见[智能计算产品兼容性查询助手](#)。

- 严禁带电搬迁设备。

单人允许搬运的最大重量

注意

单人所允许搬运的最大重量，请以当地的法律或法规为准，设备上的标识和文档中的描述信息均属于建议。

[表8-1](#)中列举了一些组织对于成年人单次所允许搬运的最大重量的规定，供参考。

表 8-1 一些组织对于成年人单次所允许搬运的最大重量的规定

组织名称	重量 (kg/lb)
CEN (European Committee for Standardization)	25/55.13
ISO (International Organization for Standardization)	25/55.13
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)	23/50.72
HSE (Health and Safety Executive)	25/55.13
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局	- 男：15/33.08 - 女：10/22.05

关于安全的更多信息，请参见《 [华为服务器 安全信息](#) 》。

8.2 维保与保修

关于维保与保修的详细信息，请参见[维保与保修信息](#)。

9系统管理

本产品集成了新一代的iBMC智能管理系统，iBMC智能管理系统是华为自主开发的具有完全自主知识产权的服务器远程管理系统。它兼容服务器业界管理标准IPMI2.0规范，具有高可靠的硬件监控和管理功能。

主要特性

iBMC智能管理系统的主要特性有：

- 支持键盘、鼠标、视频和文本控制台的重定向
- 支持远程虚拟媒体
- 支持智能平台管理接口（IPMI）
- 支持简单网络管理协议（SNMP）
- 支持通用信息模型（CIM）
- 支持Redfish
- 支持通过Web浏览器登录

主要规格

表 9-1 iBMC 智能管理系统的主要规格

规格	描述
管理接口	支持多种管理接口，满足各种方式的系统集成，可与任何标准管理系统集成，支持的接口如下所示： • IPMI • CLI • HTTPS • SNMP • Redfish
故障检测	提供丰富的故障检测功能，精确定位硬件故障，可精确到FRU。

规格	描述
系统看门狗	支持BIOS POST、OS看门狗以及故障超时自动复位系统功能，可配置各功能是否启动。
启动设备配置	启动设备可带外配置。
告警管理	支持告警管理及SNMP Trap、SMTP、syslog服务多种格式告警上报，保障设备7*24小时高可靠运行。
集成虚拟KVM	提供方便的远程维护手段，提供VNC服务，在系统故障时也无需现场操作。
集成虚拟媒体	支持将本地媒体设备或镜像、USB Key、文件夹虚拟为远程服务器的媒体设备，简化操作系统安装的复杂度。虚拟光驱最大支持8MB/s。
基于web的用户界面	支持可视化的图像界面，可以通过简单的界面点击快速完成设置和查询任务。
故障现场还原	还原故障现场信息，便于统一分析系统崩溃原因。
屏幕快照和屏幕录像	无需登录即可查看屏幕快照，让定时巡检变得简单。
黑匣子	提供黑匣子功能的开关，以及数据下载功能。
DNS/LDAP	支持域管理和目录服务，大大简化服务器管理网络 and 配置复杂度。
软件双镜像备份	当前运行的软件完全崩溃时，可以从备份镜像启动。
设备资产管理	智能的资产管理，方便统一管理和盘点在用资产。
支持智能电源管理	功率封顶技术助您轻松提高部署密度，动态节能技术助您有效降低运营费用。
IPv6	支持IPv6功能，方便构建全IPv6环境。
NC-SI功能	支持NC-SI (Network Controller Sideband Interface) 功能，助您通过业务网口访问iBMC系统。

10 通过的认证

国家/地区	认证	标准
China	RoHS	SJ/T 11363—2006 SJ/T 11364—2006 GB/T 26572—2011
China	CCC	GB4943.1-2011 GB9254-2008(Class A) GB17625.1-2012

国家/地区	认证	标准
Europe	CE	Safety: IEC 60950-1:2005(2nd Edition) +A1:2009 and/or EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+ A12:2011 EMC: EN 55022:2010 CISPR 22:2008 EN 55024:2010 CISPR 24:2010 ETSI EN 300 386 V1.6.1:2012 ETSI ES 201 468 V1.3.1:2005 IEC 61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009/EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 IEC 61000-3-3:2008/EN 61000-3-3:2008 IEC 61000-6-2:2005/EN 61000-6-2:2005 IEC 61000-6-4:2006+A1:2010/EN 61000-6-4:2007+A1:2011 RoHS: 2002/95/EC, 2011/65/EU, EN 50581: 2012 REACH: EC NO. 1907/2006 WEEE: 2002/96/EC, 2012/19/EU
America	FCC	FCC CFR47 Part 15:2005 Class A
Canada	IC	ICES-003:2004 Class A
Australia	C-tick	AS/NZS CISPR 22:2009
Japan	VCCI	VCCI V-3:2012
Saudi	SASO	IEC 60950-1: 2005 (2nd Edition) + A1:2009 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 + A12:2011
Nigeria	SONCAP	IEC 60950-1: 2005 (2nd Edition) + A1:2009 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 + A12:2011

国家/地区	认证	标准
Kuwait	Kucas	IEC 60950-1: 2005 (2nd Edition) + A1:2009 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 + A12:2011

A 附录

A.1 产品序列号

SN（Serial Number）即产品序列号，位于标签卡上，是可以唯一识别服务器的字符串组合，也是您申请华为技术有限公司进一步技术支持的重要依据。

图 A-1 SN 样例



表 A-1 SN 样例说明

序号	说明
1	序列号编号（2位），固定为“21”。
2	物料标识码（8位），即加工编码。
3	厂商代码（2位），在华为加工为“10”，在外协加工为其他值。

序号	说明
4	年月份（2位）。 - 第1位表示年份： 1~9：表示2001年~2009年 - A~H：表示2010年~2017年 - J~N：表示2018年~2022年 - P~Y：表示2023年~2032年 说明 序列号中（2010年以后）年份用26位大写字母表示，由于字母I、O、Z与数字1、0、2容易导致目视混淆，为有效区分，这三个字母禁用，相应年份顺延至下一顺位字母。 - 第2位表示月份： 1~9：表示1月~9月 - A~C：表示10月~12月
5	流水号（6位）。
6	环保属性（1位），“Y”标识为环保加工。
7	单板对内型号，即对应的产品名称。

A.2 工作温度规格限制

表 A-2 工作温度规格限制

配置	最高工作温度 35℃（95°F）	最高工作温度 40℃（104°F）	最高工作温度 45℃（113°F）
8x2.5英寸SAS/ SATA硬盘配置	支持所有配置	- 支持最高205W处理器 - 不支持配置GPU卡	- 支持最高140W处理器 - 不支持PCIe SSD卡 - 不支持配置SDI卡 - 不支持配置GPU卡
24x2.5英寸 SAS/SATA硬盘 配置	支持所有配置	- 支持最高205W处理器 - 不支持配置GPU卡	不支持
24x2.5英寸硬 盘配置 (16xSAS/ SATA +8xNVMe)	支持所有配置	- 支持最高205W处理器 - 不支持配置GPU卡	不支持

配置	最高工作温度 35℃（95°F）	最高工作温度 40℃（104°F）	最高工作温度 45℃（113°F）
25x2.5英寸 SAS/SATA硬盘 配置	支持所有配置	- 支持最高205W处理器 - 不支持配置GPU卡	不支持

 说明

- 单风扇失效时，支持的最高工作温度为正常工作温度规格以下5℃。
- 配置V100 GPU卡时，支持的最高工作温度为30℃。

A.3 RAS 特性

服务器支持多种RAS（Reliability, Availability, and Serviceability）特性。通过配置这些特性，服务器可以提供更高的可靠性、可用性和可服务性。

RAS特性的配置方法，详细信息请参见《[华为服务器 Purley平台 BIOS 参数参考](#)》。

表 A-3 支持的 RAS 特性

模块名称	特性名称	说明
CPU	CMCI（Corrected Machine Check Interrupt）	可纠正错误触发的中断。
内存	Failed DIMM Isolation	可标识故障内存，便于对故障内存进行隔离和更换。
	Memory Thermal Throttling	可自动对内存温度进行调节，防止内存过热损坏。
	Rank Sparing	使用部分内存Rank做备份，避免系统因为遇到不可纠正的错误而导致的系统崩溃。
	Memory Address Parity Protection	用于检测内存命令和地址错误。
	Memory Demand and Patrol Scrubbing	内存巡检功能，在发现可纠正错误时尽早纠正，可防止错误累积成不可纠正错误。
	Memory Mirroring	通过镜像的方式为系统提供较高的可靠性。
	SDDC（Single Device Data Correction）	实现单颗粒多比特纠错能力，可提高内存的可靠性。
	Device Tagging	可对内存故障进行降级修复，提高内存可用性。

模块名称	特性名称	说明
	Data Scrambling	可优化数据流分布，降低错误发生概率，可提升内存数据流的可靠性以及地址错误检测能力。
PCIe	PCIe Advanced Error Reporting	是一种PCIe高级错误上报机制，可提升服务器的可服务性。
UPI	Intel UPI Link Level Retry	是一种出错重试机制，提高UPI链路的可靠性。
	Intel UPI Protocol Protection via CRC	为UPI数据包提供CRC校验保护，提高系统可靠性。
System	Core Disable For FRB (Fault Resilient Boot)	BIOS启动过程中对故障的CPU core进行隔离，提高系统的可靠性和可用性。
	Corrupt Data Containment Mode	当数据发生错误时，相应的内存存储单元将会被标记出来，以限制其对当前运行的程序所造成的影响，提高系统的可靠性。
	Socket disable for FRB (Fault Resilient Boot)	BIOS启动过程中对故障的Socket进行隔离，提高系统的可靠性。
	Architected Error Records	通过eMCA等特性，由BIOS收集硬件寄存器上记录的错误信息，按照UEFI规范的格式记录下来，通过ACPI的APEI接口通知OS，定位到详细的出错单元，提示系统可用性。
	Error Injection Support	故障注入，用于各种RAS特性的验证。
	MCA (Machine Check Architecture)	是一种不可纠正错误的软件修复功能，可提升系统的可用性。
	eMCA (Enhanced Machine Check Architecture) :Gen2	增强的MCA，可提升系统的可用性。
	OOB access to MCA registers	带外系统可通过PECI访问MCA寄存器，当系统发生致命错误时，可由带外系统收集现场数据，便于后续问题分析定位，提高系统的可服务性。
	BIOS Abstraction Layer for Error Handling	BIOS对错误先做处理，再将错误信息按照规范上报OS，提升系统的可服务性。
	BIOS-based PFA (Predictive Failure Analysis)	由OS主导，BIOS提供内存错误物理单元信息，由OS进行错误的跟踪、预测，并进行相应的处理。

A.4 传感器列表

传感器	描述	位置
Inlet Temp	进风口温度	左挂耳
Outlet Temp	出风口温度	主板U60位号的器件
PCH Temp	PCH桥片温度	主板U4014位号的器件
CPU/N Core Rem	CPU核心温度	CPU，N表示CPU编号，取值1~4
CPU/N DTS	CPU DTS值	
Cpu/N Margin	Cpu1 Margin温度	
CPU/N Prochot	CPU Prochot	
CPU/N VDDQ Temp	CPU VDDQ温度	CPU1：主板U4333、U4339位号的器件 CPU2：主板U4443、U4447位号的器件 CPU3：扣板U4351、U4408位号的器件 CPU4：扣板U4411、U4414位号的器件 N表示CPU编号，取值1~4
CPU/N VRD Temp	CPU VRD温度	CPU1：主板U4316位号的器件 CPU2：主板U4430位号的器件 CPU3：扣板U4370位号的器件 CPU4：扣板U4401位号的器件 N表示CPU编号，取值1~4
CPU/N MEM Temp	CPU内存温度	CPU对应的内存，N表示CPU编号，取值1~4
SSD Disk/N Temp	检测SSD盘温度状态	SSD硬盘，N表示硬盘槽位编号
FAN/N F Speed	风扇转速	风扇模块，N表示风扇模块编号，取值1~5
FAN/N R Speed		
Power	整机输入功率	电源模块功率之和

传感器	描述	位置
PowerN	电源输入功率	电源模块，N表示电源模块编号，取值1~4
CPU N Status	CPU状态检测	CPU，N表示CPU编号，取值1~4
CPU N Memory	内存状态检测	CPU对应的内存，N表示内存编号，取值1~4
PSN Fan Status	电源风扇故障状态	电源模块，N表示电源模块编号，取值1~4
PSN Temp Status	电源在位状态	
PSN Status	电源故障状态	
Power Button	power button按下	右挂耳
UID Button	UID button状态	
DISKN	硬盘状态	硬盘，N表示硬盘物理槽位编号
FAN N F Presence	风扇在位	风扇模块，N表示风扇模块编号，取值1~5
FAN N R Presence		
FAN N F Status	风扇故障状态	
FAN N R Status		
RTC Battery	RTC电池状态，低于1V告警	CMOS电池
DIMMN	内存DIMM状态	内存，N表示内存槽位编号
PCH Status	PCH芯片故障诊断健康状态	主板U4014位号的器件
LCD Presence	LCD在位	LCD屏
LCD Status	LCD健康状态	
PS Redundancy	电源拔出冗余失效告警	电源模块，N表示电源模块编号，取值1~2
PSN Inlet Temp	电源进风口温度	
PSN VIN	电源输入电压	不涉及，N表示所属器件的编号
PwrOk Sig. Drop	电压跌落状态	
ACPI State	ACPI状态	
SysFWProgress	系统软件进程、系统启动错误	
SysRestart	系统重启原因	

传感器	描述	位置
Boot Error	BOOT错误	
Watchdog2	看门狗	
Mngmnt Health	管理子系统健康状态	
Riser1 Card	实体在位	
SAS Cable	实体在位	
PCIe RAID/N Temp	3508 RAID卡温度	
PCIe RAID/N Temp	3004 RAID卡温度	
M2 Temp(PCIeM)	RAID标卡上所有M.2盘的最大温度	
PCIe Status	PCIe状态错误	
PwrOn TimeOut	上电超时	
PwrCap Status	功率封顶状态	
HDD Backplane	硬盘背板实体在位状态	
HDD BP Status	硬盘背板健康状态	
Port/N Link Down (N 1. 2. 3. 4)	网口link状态	
CPU/N UPI Link (N 1. 2. 3.4)	CPU的UPI链路故障诊断健康状态	
System Notice	提示热重启，为故障诊断程序收集错误信息	
System Error	系统挂死或重启，请查看后台日志	
BMC Boot Up	记录BMC启动事件	
SEL Status	记录SEL快满/被清除事件	
Op. Log Full	记录操作日志快满/清除事件	
Sec. Log Full	记录安全日志快满/清除事件	
CPU Usage	CPU占用率检测	
Memory Usage	mem占用率检测	
PCIe/N Card BBU	PCIe标卡BBU故障/低电压	
BMC Time Hopping	记录时间跳变时间	

传感器	描述	位置
NTP Sync Failed	记录NTP同步失败和恢复事件	
Host Loss	记录业务测系统监控软件（ BMA ）是否链路丢失	
PCIe/N Inlet Temp	SDI卡入风口温度	
PCIe/N Cpu Temp	SDI卡CPU温度	
GPU/N Temp	GPU卡温度	
P100GPU/N Temp		
P4GPU/N Temp		
P40GPU/N Temp		
SYS 3.3V	主板3.3V电压	
SYS 5V	主板5.0V电压	
SYS 12V_1	主板12.0V电压(电源缓起第一路输出12V电压侦测（ CPU1模块+PCIe Slot ）)	
SYS 12V_2	主板12.0V电压(电源缓起第二路输出12V电压侦测（ CPU2模块+CPU3模块 ）)	
SYS 12V_3	主板12.0V电压(电源缓起第三路输出12V电压侦测（ CPU4模块+风扇模块 ）)	
SYS 12V_4	主板12.0V电压(电源缓起第四路输出12V电压侦测（ 硬盘背板模块 ）)	
SYS 12V_5	主板12.0V电压(电源缓起第四路输出12V电压侦测（ 硬盘背板模块 ）)	
Standby 5V	主板Standby5.0V电压	
Standby 3.3V	主板Standby3.3V电压	
Standby 1.8V	主板Standby1.8V电压	
Standby 1.5V	主板Standby1.5V电压	
CPU/N VCore	1.8V CPU电压	
CPU/N DDR VDDQ	CPU内存电压	
CPU/N DDR VDDQ2	CPU内存电压	

传感器	描述	位置
CPU/VSA	CPU VSA电压	
CPU/VCCIO	CPU VCCIO电压	
PCH VPVNN	PCH PVNN电压	
PCH PRIM 1V05	PCH 1.05V电压	
SSD/Temp	ES3000 V3温度	

B 术语

B.1 A-E

B

baseboard management controller (BMC, 底板管理控制器)	BMC是IPMI规范的核心，负责各路传感器的信号采集、处理、储存，以及各种器件运行状态的监控。BMC向机箱管理模块提供被管理对象的硬件状态及告警等信息，实现对被管理对象的设备管理功能。
---	--

E

ejector lever (扳手)	面板上的一个器件，用于把设备插入或拔出槽位。
Ethernet (以太网)	Xerox公司创建，并由Xerox、Intel、DEC公司共同发展的一种基带局域网规范，使用CSMA/CD，以10Mbit/s速率在多种电缆上传输，类似于IEEE 802.3系列标准。

B.2 F-J

G

Gigabit Ethernet (GE, 千兆以太网)	千兆以太网是一种对传统的共享介质以太网标准的扩展和增强，兼容10M及100M以太网，符合IEEE 802.3z标准的以太网。
-------------------------------------	--

H

hot swap (热插拔)	一项提高系统可靠性和可维护性的技术，能保证从正在运行的系统中，按照规定插入或拔出功能模块，不对系统正常工作造成影响。
-----------------------	--

B.3 K-O

K

keyboard, video and mouse (KVM, 键盘, 显示器, 鼠标三合一)	键盘、显示器和鼠标。
--	------------

B.4 P-T

P

panel (面板)	面板是服务器前视图/后视图所见的平面上的对外部件（包括但不限于扳手、指示灯和端口等器件），同时起到为气流和EMC密封机箱前部和后部的作用。
Peripheral Component Interconnect Express (PCIe, 快捷外围部件互连标准)	电脑总线PCI的一种，它沿用了现有的PCI编程概念及通讯标准，但建基于更快的串行通信系统。英特尔是该接口的主要支援者。PCIe仅应用于内部互连。由于PCIe是基于现有的PCI系统，只需修改物理层而无须修改软件就可将现有PCI系统转换为PCIe。PCIe拥有更快的速率，以取代几乎全部现有的内部总线（包括AGP和PCI）。

R

redundancy (冗余)	冗余指当某一设备发生损坏时，系统能够自动调用备用设备替代该故障设备的机制。
redundant array of independent disks (RAID, 独立磁盘冗余阵列)	RAID是一种把多块独立的硬盘（物理硬盘）按不同的方式组合起来形成一个硬盘组（逻辑硬盘），从而提供数据冗余和比单个硬盘更高的存储性能的技术。

S

server (服务器)	服务器是在网络环境中为客户 (Client) 提供各种服务的特殊计算机。
system event log (SEL, 系统事件日志)	存储系统事件信息的不可变的存储区域和相关接口, 用于随后的故障诊断和系统修复。

B.5 U-Z

U

U	IEC 60297-1规范中对机柜、机箱、子架垂直高度的计量单位。1U=44.45mm。
UltraPath Interconnect (UPI, 超级通道互联)	英特尔的下一代点对点互联结构。

C 缩略语

C.1 A-E

A

AC	Alternating Current (交流电)
AES	Advanced Encryption Standard New Instruction Set (高级加密标准新指令集)
ARP	Address Resolution Protocol (地址解析协议)
AVX	Advanced Vector Extensions (高级矢量扩展指令集)

B

BBU	Backup Battery Unit (备份电池单元)
BIOS	Basic Input Output System (基本输入输出系统)
BMC	Baseboard Management Controller (主板管理控制单元)

C

CD	Calendar Day (日历日)
CE	Conformite Europeenne (欧洲合格认证)
CIM	Common Information Model (通用信息模型)
CLI	Command-line Interface (命令行接口)

D

DC	Direct Current (直流电)
DDR3	Double Data Rate 3 (双倍数据速率3)
DDR4	Double Data Rate 4 (双倍数据速率4)
DDDC	Double Device Data Correction (双设备数据校正)
DEMT	Dynamic Energy Management Technology (动态能耗管理技术)
DIMM	Dual In-line Memory Module (双列直插内存模块)
DRAM	Dynamic Random-Access Memory (动态随机存储设备)
DVD	Digital Video Disc (数字视频光盘)

E

ECC	Error Checking and Correcting (差错校验纠正)
ECMA	European Computer Manufacturer Association (欧洲计算机制造协会)
EDB	Execute Disable Bit (执行禁卫)
EN	European Efficiency (欧洲标准)
ERP	Enterprise Resource Planning (企业资源计划)
ETS	European Telecommunication Standards (欧洲电信标准)

C.2 F-J

F

FB-DIMM	Fully Buffered DIMM (全缓存双列内存模组)
FC	Fiber Channel (光线通道)
FCC	Federal Communications Commission (美国联邦通信委员会)
FCoE	Fibre Channel Over Ethernet (以太网光纤通道)
FTP	File Transfer Protocol (文本传输协议)

G

GE	Gigabit Ethernet (千兆以太网)
GPIO	General Purpose Input/Output (通用输入输出)
GPU	Graphics Processing Unit (图形处理单元)

H

HA	High Availability (高可用性)
HDD	Hard Disk Drive (硬盘驱动器)
HPC	High Performance Computing (高性能计算)
HTTP	Hypertext Transfer Protocol (超文本传输协议)
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure (超文本传输安全协议)

I

iBMC	Intelligent Baseboard Management Controller (智能管理单元)
IC	Industry Canada (加拿大工业部)
ICMP	Internet Control Message Protocol (因特网控制报文协议)
IDC	Internet Data Center (Internet数据中心)
IEC	International Electrotechnical Commission (国际电工技术委员会)
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers (电气和电子工程师学会)
IGMP	Internet Group Message Protocol (因特网组播管理协议)
IOPS	Input/Output Operations per Second (每秒进行读写操作的次数)
IP	Internet Protocol (互联网协议)
IPC	Intelligent Power Capability (智能电源管理功能)
IPMB	Intelligent Platform Management Bus (智能平台管理总线)

IPMI	Intelligent Platform Management Interface (智能平台管理接口)
-------------	--

C.3 K-O

K

KVM	Keyboard, Video and Mouse (键盘, 显示器, 鼠标三合一)
------------	--

L

LC	Lucent Connector (符合朗讯标准的光纤连接器)
LRDIMM	Load-Reduced Dual In-line Memory Module (低负载双 线内存模块)
LED	Light Emitting Diode (发光二极管)
LOM	LAN on Motherboard (板载网络)

M

MAC	Media Access Control (媒体接入控制)
MMC	Module Management Controller (模块管理控制器)

N

NBD	Next Business Day (下一个工作日)
NC-SI	Network Controller Sideband Interface (边带管理)

C.4 P-T

P

PCIe	Peripheral Component Interconnect Express (快捷外围 部件互连标准)
PDU	Power Distribution Unit (配电单元)

PHY	Physical Layer (物理层)
PMBUS	Power Management Bus (电源管理总线)
POK	Power OK (电源正常)
PWM	Pulse-width Modulation (脉冲宽度调制)
PXE	Preboot Execution Environment (预启动执行环境)

Q

QPI	QuickPath Interconnect (快速通道互联)
------------	---------------------------------

R

RAID	Redundant Array of Independent Disks (独立磁盘冗余阵列)
RAS	Reliability, Availability and Serviceability (可靠性、可用性、可服务性)
RDIMM	Registered Dual In-line Memory Module (带寄存器的双 线内存模块)
REACH	Registration Evaluation and Authorization of Chemicals (关于化学品注册、评估、许可和限制的法规)
RJ45	Registered Jack 45 (RJ45插座)
RoHS	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (特定有害物质禁 限用指令)

S

SAS	Serial Attached Small Computer System Interface (串 行连接的小型计算机系统接口)
SATA	Serial Advanced Technology Attachment (串行高级技术 附件)
SCM	Supply Chain Management (供应链管理)
SDDC	Single Device Data Correction (单设备数据校正)
SERDES	Serializer/Deserializer (串行器/解串器)
SGMII	Serial Gigabit Media Independent Interface (串行千兆 以太网媒体无关接口)

SMI	Serial Management Interface (串行管理接口)
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol (简单邮件传输协议)
SNMP	Simple Network Management Protocol (简单网络管理协议)
SOL	Serial Over LAN (串口重定向)
SONCAP	Standards Organization of Nigeria-Conformity Assessment Program (尼日利亚认证强制性合格评定程序)
SSD	Solid-State Drive (固态硬盘)
SSE	Streaming SIMD Extension (流技术扩展指令集)

T

TACH	Tachometer Signal (测速信号)
TBT	Turbo Boost Technology (智能加速技术)
TCG	Trusted Computing Group (可信计算组)
TCM	Trusted Cryptography Module (可信密码模块)
TCO	Total Cost of Ownership (总体拥有成本)
TDP	Thermal Design Power (热设计功率)
TELNET	Telecommunication Network Protocol (电信网络协议)
TET	Trusted Execution Technology (可信执行技术)
TFM	Trans Flash Module (闪存卡)
TFTP	Trivial File Transfer Protocol (简单文本传输协议)
TOE	TCP Offload Engine (TCP减负引擎)
TPM	Trusted Platform Module (可信平台模块)

C.5 U-Z

U

UDIMM	Unbuffered Dual In-line Memory Module (无缓冲双通道内存模块)
UEFI	Unified Extensible Firmware Interface (统一可扩展固件接口)

UID	Unit Identification Light (定位指示灯)
UL	Underwriter Laboratories Inc. ((美国) 保险商实验室)
USB	Universal Serial Bus (通用串行总线)

V

VCCI	Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (电磁干扰控制委员会)
VGA	Video Graphics Array (视频图形阵列)
VLAN	Virtual Local Area Network (虚拟局域网)
VRD	Voltage Regulator-Down (电源稳压器)

W

WEEE	Waste Electrical and Electronic Equipment (废弃电子电机设备)
WSMAN	Web Service Management (Web服务管理协议)